

**Infineon**

# Unternehmensüberblick

Juli 2005



Never stop thinking.

# Inhaltsverzeichnis

---



**Markt**

**Unternehmensüberblick**

**Mission**



**Geschäftsentwicklung 3. Quartal Geschäftsjahr 2005**



**Geschäftsbereiche**



**Allgemeine Unternehmensdaten**

---

|   |  |                       |         |
|---|--|-----------------------|---------|
|    | <b>Markt</b>                                       | Unternehmensüberblick | Mission |
|    | Geschäftsentwicklung 3. Quartal Geschäftsjahr 2005 |                       |         |
|   | Geschäftsbereiche                                  |                       |         |
|  | Allgemeine Unternehmensdaten                       |                       |         |

# Entwicklungen und Prognosen Halbleitermarkt 1993 - 2006

|  Prognosen* | 2005  | 2006 |
|--|-------|------|
| IC Insights  | +4 %  | +8 % |
| WSTS**   | +6 %  | +5 % |
| Future Horizons  | +15 % | +6 % |
| Gartner DQ   | +6 %  | +7 % |
| iSuppli  | +6 %  | +3 % |
| VLSI Research  | +6 %  | -9 % |

[Mrd. USD]

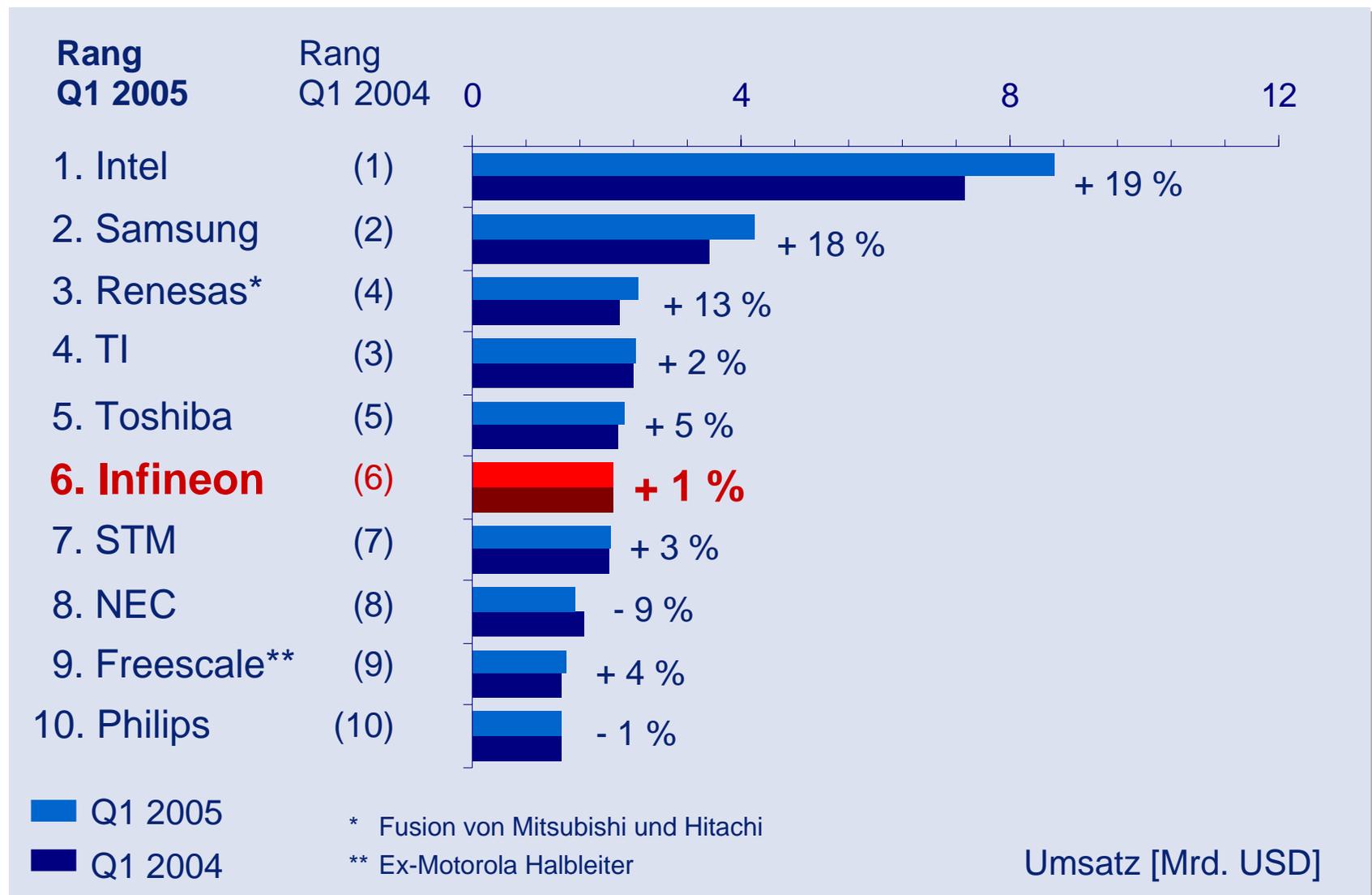


Quelle: WSTS für historische Daten

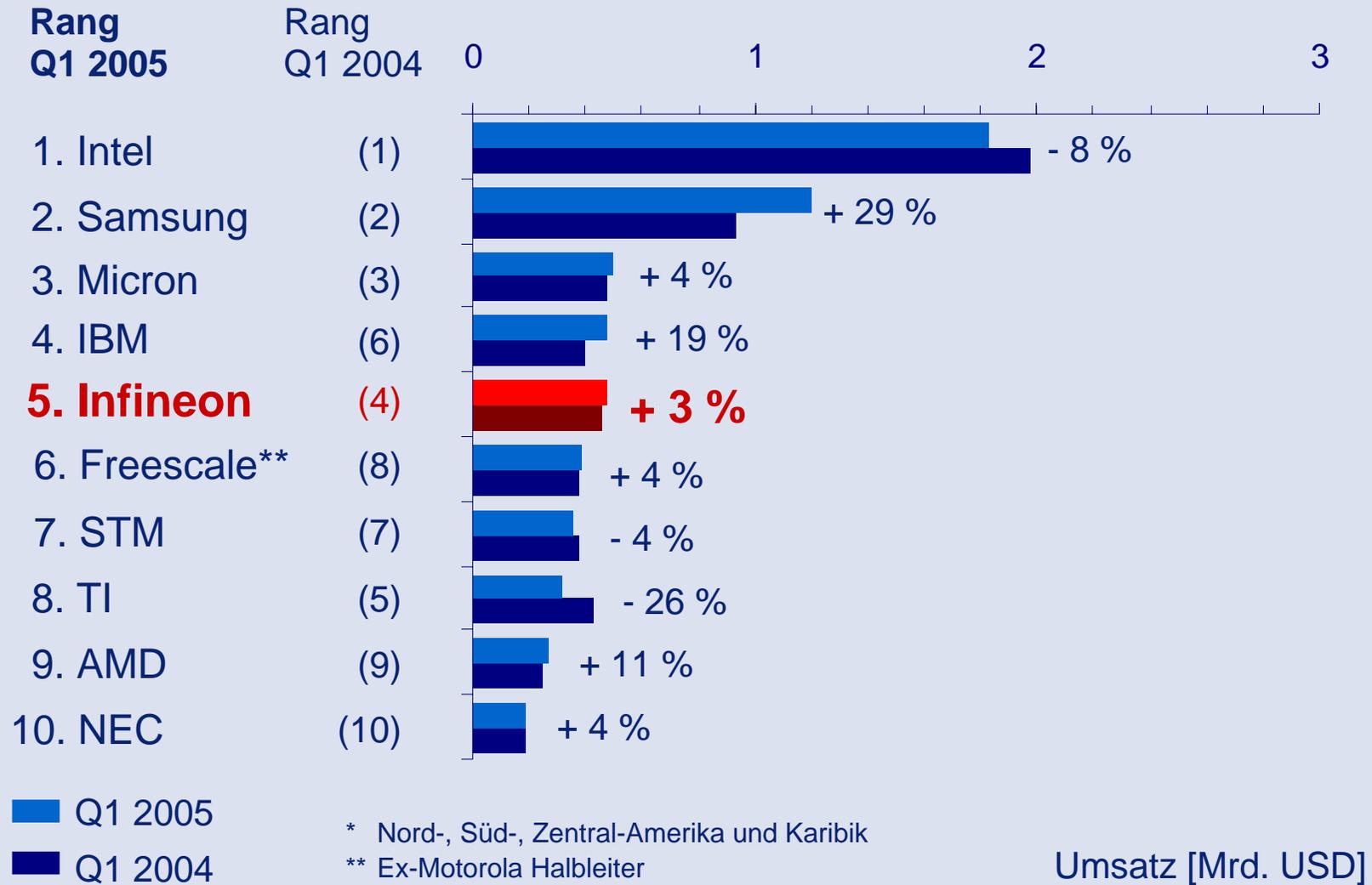
\* Stand 12. Juli 2005

\*\* inkl. Aktualisierung 1Q KJ 2005

# Weltweites Ranking Halbleiterunternehmen Q1 2005 und Q1 2004

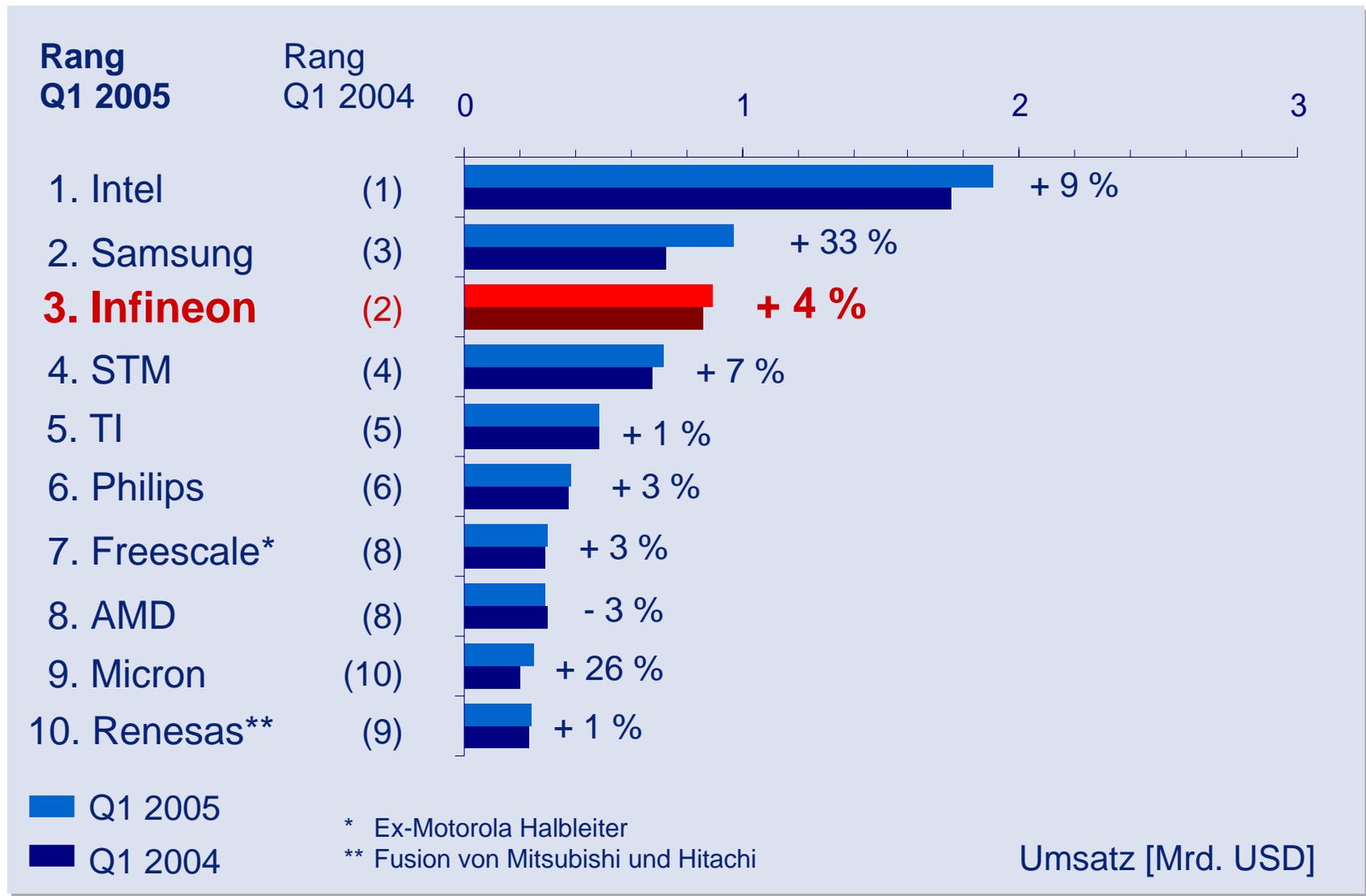


# Ranking Amerika\*



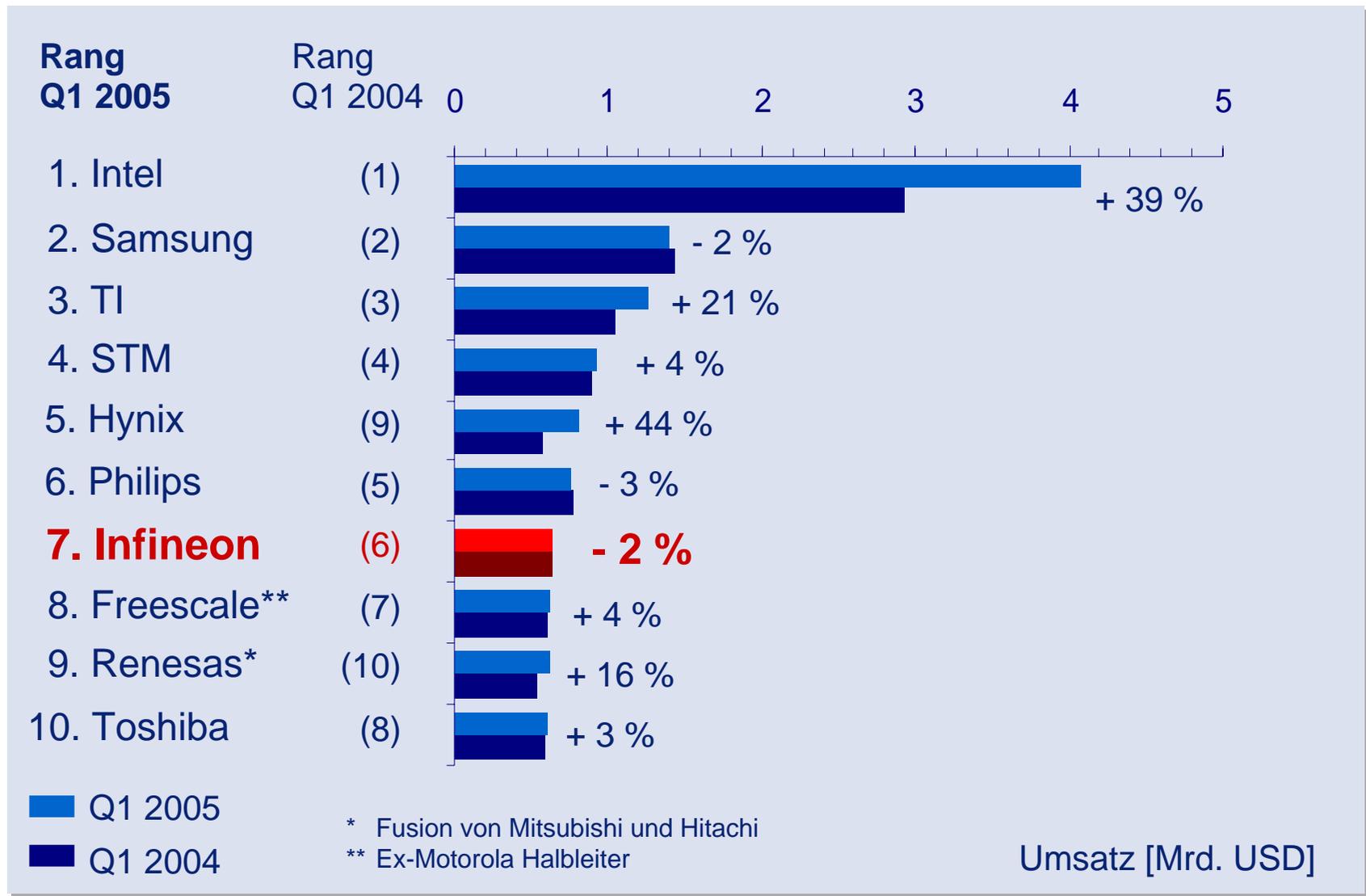
# Ranking Europa

stop thinking  
never

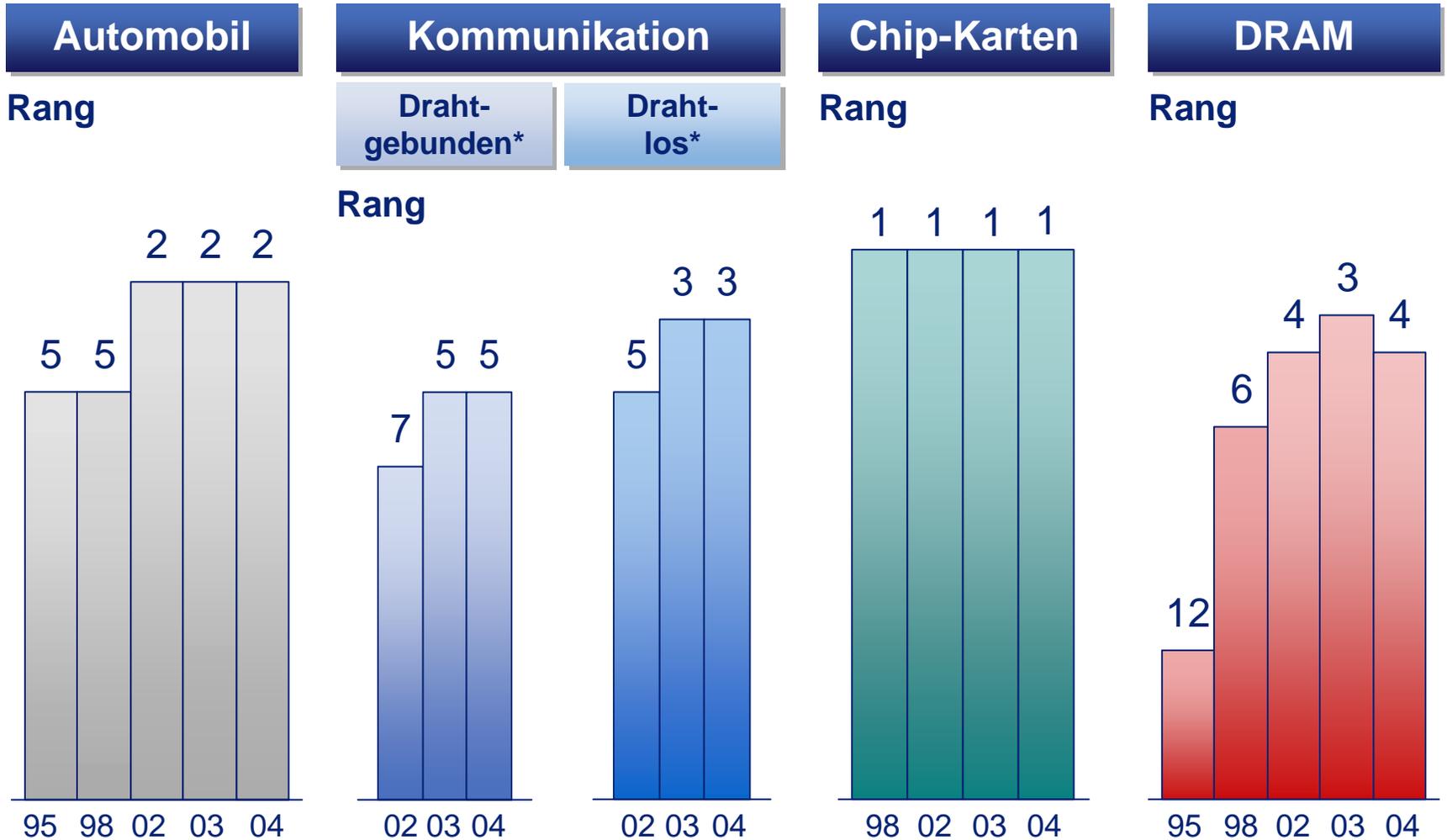


# Ranking Asien

stop thinking  
never



# Ranking in allen Zielmärkten



\* Anwendungs-spezifische Halbleiterprodukte  
 Quelle: Gartner Dataquest (März 2005); iSuppli (März 2005)

---

-  Markt
-  Unternehmensüberblick
-  Mission
-  Geschäftsentwicklung 3. Quartal Geschäftsjahr 2005
-  Geschäftsbereiche
-  Allgemeine Unternehmensdaten

## Infineon auf einen Blick

---

- Infineon – Nr. 6 unter den Halbleiterunternehmen weltweit
- Umsatz von 7,2 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2004; Umsatzwachstum von 17 % im Vergleich zum Vorjahr
- Rund 36.000 Mitarbeiter, davon rund 7.300 in Forschung und Entwicklung\*
- Starke technologische Basis mit rund 41.000 Patenten und Anmeldungen; über 35 Hauptstandorte für Forschung und Entwicklung
- Modernste Fertigung bei 300-mm-Produktion
- Fokus auf Automobil-, Industrieelektronik, Sicherheit und Chipkarten, Kommunikation und Speicher

# Infineon – marktorientierte Unternehmensstruktur

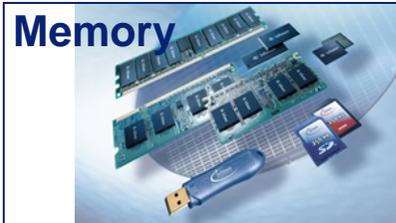
## Marktorientierte Bereiche

## Applikationen



# Infineons Technologiekompetenz

stop thinking never



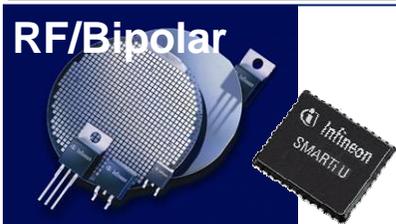
## Memory

**DRAM:** 170nm – 90nm Trench  
**eDRAM:** 170nm Trench  
**Nonvolatile Memory:** 170nm – 110nm TwinFlash  
**Various Future Memory Technologies under review and development**



## CMOS

**Digital CMOS:** 1200nm – 90nm Technology Nodes (Platform <180nm incl. RF, AMS)  
**Analog/Mixed Signal:** 1000nm – 180nm Technology Nodes (CxPA, CyNA)  
**eNVM:** EEPROM: M3FR (Low Cost), IMEM, C5FR3,  
 OTP: C5OP (Automotive)  
**eFlash/EEPROM:** 500nm – 130nm CxFL (Chip Card), CxFLA, CxFLN (Automotive)



## RF/Bipolar

**RF BICMOS:** 25GHz – 75GHz BxHFC, B9COPT  
**Bipolar IC:** <200GHz NF-IC, RF-Bipolar: BxHF, SiGe: B7HFxx, B7HF200, RF Power: BxP  
**Bipolar/Discretes/MMIC:**  
 Diodes: NF-DI, Tuner: DxT, PIN: DxP, Schottky: DxS  
 RFMOS: HF MOS, LDMOS, LDCAP  
 AF Transistors NF-TR; RF-Transistors HFBxN/P, BxHF(D/M), B6HFE, RF Bipolar/SiGE: B7HF



## Power/Analog

**Bipolar:** DOPL, Ax, BIPEP  
**Analog:** SPT170, B6CA, HV-CMOS-SOI  
**Smart Power (BCD):** SPTx (Automotive, EDP)  
**Smart (SmartMOS CD):** SMARTx, MSMARTx, SSMARTx, Opto-TRIAC  
**SiC Devices:** Diode; JEFET (Research)  
**DMOS (OptiMOS):** KSPx, PFET KSNx, EH4, EHmilli, SFETx  
**HV-DMOS (CooliMOS):** EH5/6, APT6, EHATx, EHATDx, EHCx  
**IGBT:** IGBTx, LightMOS, ZIGBT,  
**Fast Recovery Diodes:** FRSTDx (EMCONx)



## MEMS

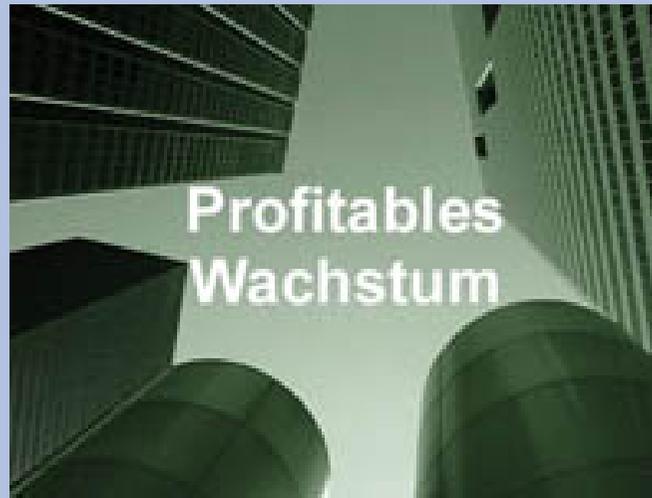
**Temperature:** D-TEMP  
**Hall:** BxCAS, C9FLRN\_GMR, CxHV  
**Pressure:** BxCSP, PIEZO, TIREPx,  
**Inertia:** GYRO  
**Distance Radar**  
**RF MEMs:** Int. Passives, Filter, RF-Networks  
**Microphone**  
**Opto** OP-DI, OP-TR

---

-  Markt
-  Unternehmensüberblick
-  **Mission**
-  Geschäftsentwicklung 3. Quartal Geschäftsjahr 2005
-  Geschäftsbereiche
-  Allgemeine Unternehmensdaten

## Infineon's vier Säulen

---



## Neue Infineon Mission basierend auf vier Säulen

---

- **Kundenorientierung:**

Wir denken an unsere Kunden zuerst; wir bieten innovative Halbleiterlösungen, für die Bedürfnisse unserer Kunden, heute und in der Zukunft.



- **Operative Spitzenleistung:**

Wir wollen die Besten in Bezug auf Kosten, Qualität und Zeit bis zur Markteinführung sein.



- **Profitables Wachstum:**

Wir konzentrieren uns auf profitables Wachstum im Interesse unserer Aktionäre und Mitarbeiter.



- **Kooperative Führung:**

Wir fördern eine kooperative Kultur und arbeiten als globales Team für den Erfolg unserer Kunden.



---

- Markt
- Unternehmensüberblick
- Mission
- **Geschäftsentwicklung 3. Quartal Geschäftsjahr 2005**
- Geschäftsbereiche
- Allgemeine Unternehmensdaten

# Marktumfeld und Geschäftslage Infineon Q3 GJ 2005

## Infineon

- Stabile Umsatzentwicklung im 3. Quartal
- Erheblicher Preisdruck im Speichermarkt
- Rapider Preisverfall bei Chipkarten-ICs
- EBIT enthält Sondereffekte i. H. v. 81 Mio. Euro, EBIT-Verlust insgesamt 234 Mio. Euro
- Nettoverlust von 240 Millionen Euro

### AIM

- Umsatz leicht rückläufig, vor allem wegen unerwartet hohen Preisrückgangs bei Chipkarten-ICs
- Höherer Umsatz bei Automobil- und Industrieelektronik
- EBIT-Rückgang vor allem auf starken Preisdruck bei Chipkarten-ICs zurückzuführen

### COM

- Leicht geringerer Umsatz durch Preisdruck
- Nachfragerückgang für Basisband-Produkte
- Erhebliche Verringerung des EBIT-Verlusts
- Geringere Leerstandskosten, Effizienzprogramme und niedrigere F+E-Ausgaben dafür hauptverantwortlich

### MP

- Erheblicher Rückgang der Bit-Preise um etwa 30 %
- Trotzdem höherer Umsatz wegen Wachstum des Bit-Volumens um 45 %
- Größerer Preisverfall als erwartet und Kosten für Hochlauf 300-mm-Werk Richmond verantwortlich für EBIT-Rückgang

# Business Highlights Q3 GJ 2005

## Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket

---

- Continental zeichnete Infineon mit dem Supplier Award 2004 für herausragende logistische Leistungen und Qualität aus. Zudem hat Astec dem Unternehmen seinen Quality Award für die Implementierung des Infineon-Zero-Defect-Programms verliehen, das bei IBM gestartet wurde.
- Infineon wird die deutschen Behörden mit Sicherheits-Chips für die elektronischen Pässe der nächsten Generation beliefern, die voraussichtlich ab November 2005 ausgegeben werden. Für Personalausweise und Pässe wird das Unternehmen ferner ein spezielles Chip-Package sowie das Inlay mit Antenne und Chip-Anschluss bereitstellen.
- Im dritten Quartal unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung mit einem führenden Festplattenhersteller über die Entwicklung eines Produkts für den Einstieg in den neuen und schnell wachsenden Markt für mobile Anwendungen.

# Business Highlights Q3 GJ 2005

## Kommunikation

- Wir haben unsere ersten UMTS CMOS Single-Chip Hochfrequenz-Transceiver für sechs Frequenzbereiche vorgestellt, die den weltweiten Einsatz von UMTS-Telefonen ermöglichen. Mit dem neuen SMARTi 3G, dem weltweit ersten CMOS RF Transceiver speziell für UMTS-Anwendungen, konnten wir bereits Design-Wins bei verschiedenen Kunden verzeichnen.
- Wir haben eine neue Multimedia-Telefonplattform vorgestellt, die die Mobilfunkstandards GPRS und EDGE unterstützt. Die MP-E-Plattform enthält alle erforderlichen Hardware- und Software-Komponenten für leistungsfähige Mobiltelefone mit innovativen Multimedia-Funktionen wie Video-Streaming, -aufnahme und -wiedergabe. Die echte 3-Chip-Lösung mit Multimedia-Basisband, Power-Management-Einheit und CMOS RF Transceiver ermöglicht eine der kleinsten Plattformen in dieser Industrie.
- Mit dem verfügbaren Muster des VINAX-Chips haben wir die industrieweit erste Standard-konforme VDSL2-end-to-end-Lösung angekündigt. Mit VINAX erweitern wir unser DSL-Portfolio und erreichen eine führende Position im Markt für VDSL2-Lösungen, die Voraussetzung ist für Triple-Play-Services wie Mehrkanal-HDTV, Online- / On-Demand-Spiele und Videoanwendungen, Voice-over-IP sowie Highspeed-Internet-Zugänge.

# Business Highlights Q3 GJ 2005

## Speicherprodukte

---

- Beginn der Serienproduktion mit 90-Nanometer-Trench-Technologie für DRAMs auf 300-Millimeter-Wafern. Bereits zwei Produkte verfügbar: 512M DDR und 512M DDR2.
- Starkes Bit-Wachstum von etwa 45 % im Vergleich zum Vorquartal.
- Gestiegener Anteil an Spezial-DRAMs (Graphik und Mobile RAM).
- Bemusterung von kundenspezifischen 8 GB (Gigabyte) DDR2-400 Tall registered DIMMs auf Basis der dual-die Technologie gestartet.
- Infineon hat als erster im Markt Komponenten mit vollständiger DDR3 Schnittstellen-Funktionalität an eine der größten PC Entwickler geliefert.
- Infineon ist die einzige Firma, die eine komplett eigene Lösung für die nächste Generation von Server-Modulen (FB-DIMMs) anbieten kann, bestehend aus Speichermodul, AMB-Chip und Kühlkörper.

# Umsatz- und Ergebnisentwicklung Infineon, Vergleich Q2 2005 mit Q3 2005 und 9 Monate GJ 2004 mit 9 Monate 2005

| (nach US GAAP [Mio. EUR])                                       | Q2<br>GJ 2005 | Q3<br>GJ 2005 | Ver-<br>änderung | 9 Monate<br>GJ 2004 | 9 Monate<br>GJ 2005 | Ver-<br>änderung |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Umsatzerlös</b>  | <b>1.606</b>  | <b>1.606</b>  | <b>0</b>         | <b>5.202</b>        | <b>5.028</b>        | <b>(174)</b>     |
| Wachstum (%)  |               | 0             |                  |                     | (3)                 |                  |
| <b>EBIT</b>   | <b>(117)</b>  | <b>(234)</b>  | <b>(117)</b>     | <b>143</b>          | <b>(140)</b>        | <b>(283)</b>     |
| <b>Konzernüberschuss<br/>/ (-fehlbetrag)</b>                    | <b>(114)</b>  | <b>(240)</b>  | <b>(126)</b>     | <b>17</b>           | <b>(212)</b>        | <b>(229)</b>     |
| <b>Konzernüberschuss<br/>/ (-fehlbetrag)<br/>je Aktie [EUR]</b> | <b>(0,15)</b> | <b>(0,32)</b> | <b>(0,17)</b>    | <b>0,02</b>         | <b>(0,28)</b>       | <b>(0,30)</b>    |

## Umsatz- und EBIT-Entwicklung (1 von 2)

| Umsätze und EBIT   |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| (nach US GAAP [Mio. EUR])  | Q3 03/04 | Q4 03/04 | Q1 04/05 | Q2 04/05 | Q3 04/05 |
| <b>Automobil-,<br/>Industrieelektronik<br/>&amp; Multimarket</b> |          |          |          |          |          |
| Umsatz   | 669      | 708      | 631      | 634      | 625      |
| EBIT   | 74       | 90       | 48       | 36       | 23       |
| <b>Kommunikation</b>   |          |          |          |          |          |
| Umsatz   | 419      | 466      | 414      | 332      | 314      |
| EBIT   | 2        | (73)     | (19)     | (142)    | (88)     |
| <b>Speicher-Produkte</b>   |          |          |          |          |          |
| Umsatz   | 811      | 807      | 766      | 633      | 659      |
| EBIT   | (50)     | 149      | 196      | 17       | (125)    |

Die Segmentdaten der Vorperioden wurden auf Grundlage der aktuellen Segmentstruktur für weitergehendes Geschäft vergleichbar gerechnet.

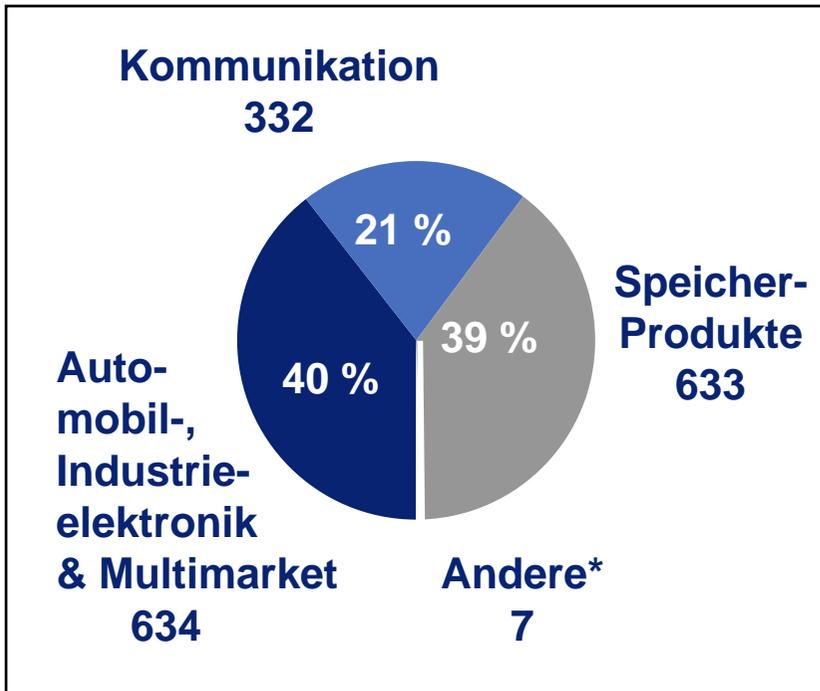
## Umsatz- und EBIT-Entwicklung (2 von 2)

| Umsätze und EBIT          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (nach US GAAP [Mio. EUR]) | Q3 03/04 | Q4 03/04 | Q1 04/05 | Q2 04/05 | Q3 04/05 |
| <b>Sonstige</b>           |          |          |          |          |          |
| Umsatz                    | 1        | 3        | 3        | 4        | 3        |
| EBIT                      | (9)      | (35)     | (2)      | 11       | (1)      |
| <b>Konzernfunktionen</b>  |          |          |          |          |          |
| Umsatz                    | 8        | 9        | 2        | 3        | 5        |
| EBIT                      | (15)     | (18)     | (12)     | (39)     | (43)     |

Die Segmentdaten der Vorperioden wurden auf Grundlage der aktuellen Segmentstruktur für weitergehendes Geschäft vergleichbar gerechnet.

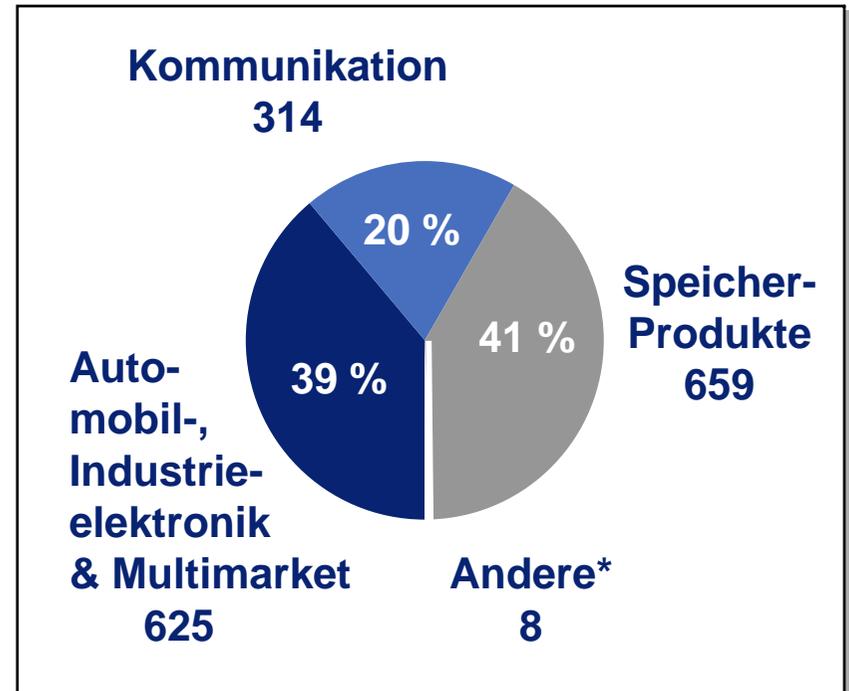
# Umsatzentwicklung nach Segmenten, 2. Quartal GJ 2005 und 3. Quartal GJ 2005

## Q2 GJ 2005



**Gesamt: 1.606 Mio. EUR**

## Q3 GJ 2005



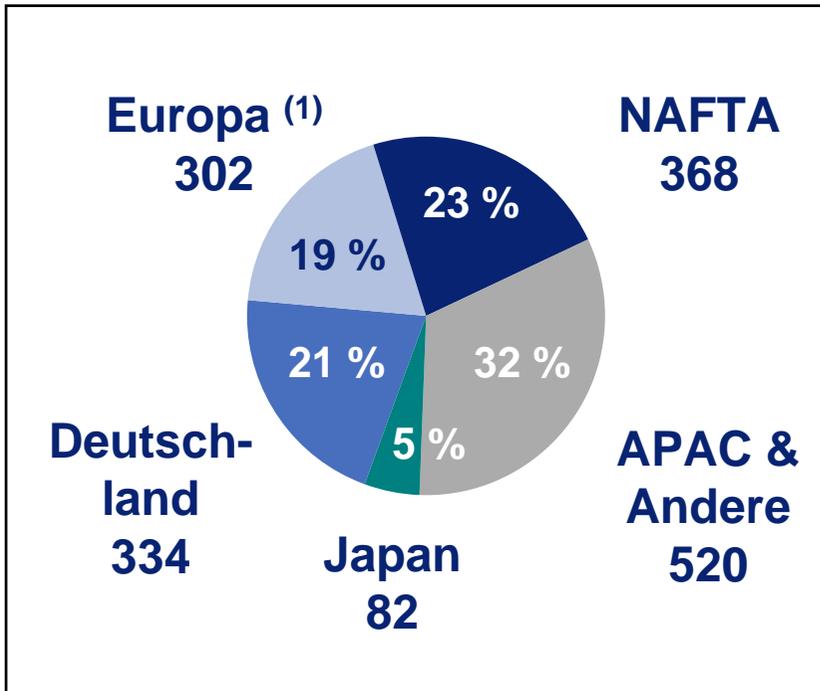
**Gesamt: 1.606 Mio. EUR**

(nach US GAAP)

\* beinhaltet Konzernfunktionen und sonstige Geschäftsbereiche

# Umsatzentwicklung nach Regionen, 2. Quartal GJ 2005 und 3. Quartal GJ 2005

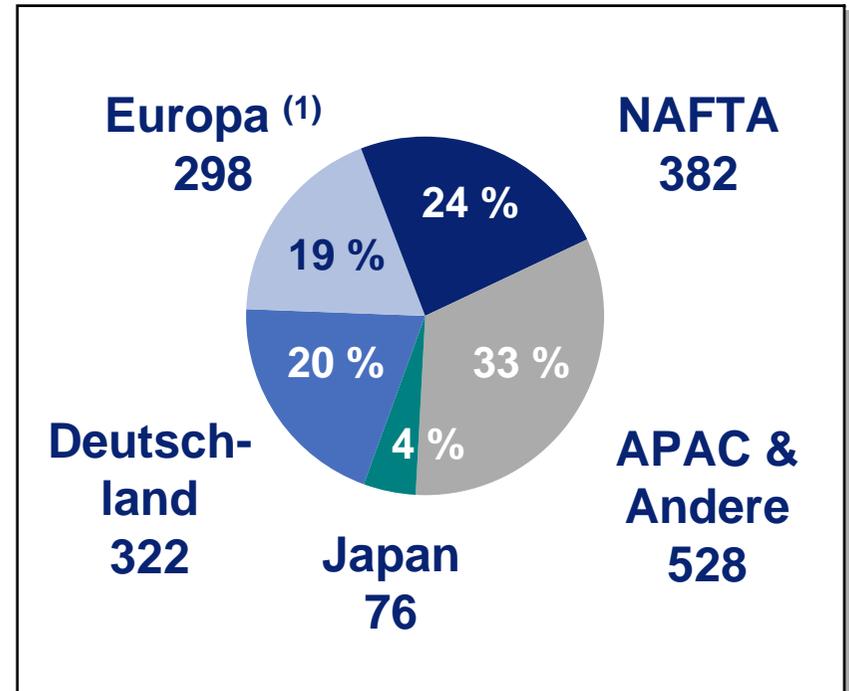
## Q2 GJ 2005



**Gesamt: 1.606 Mio. EUR**

(1) Ohne Deutschland

## Q3 GJ 2005

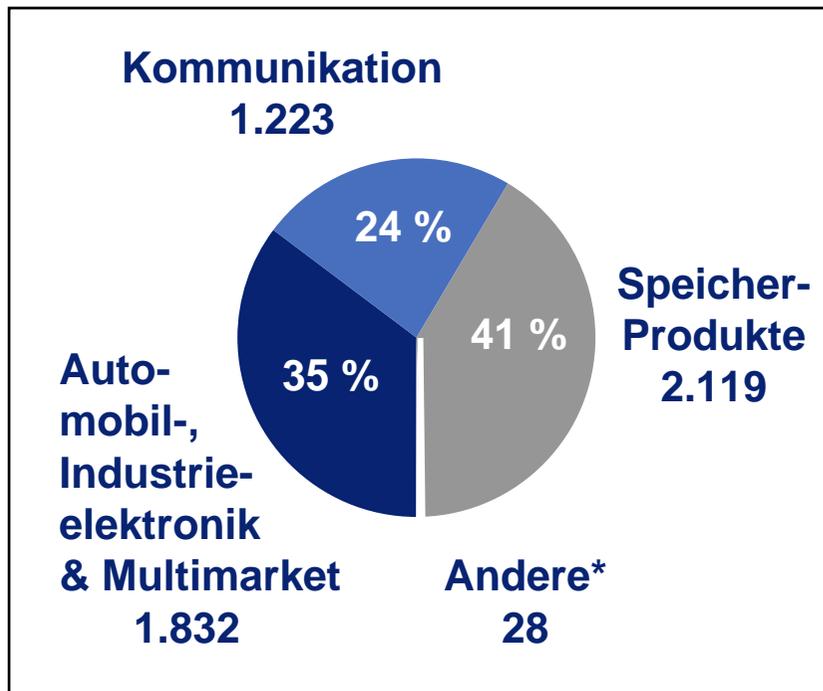


**Gesamt: 1.606 Mio. EUR**

(nach US GAAP)

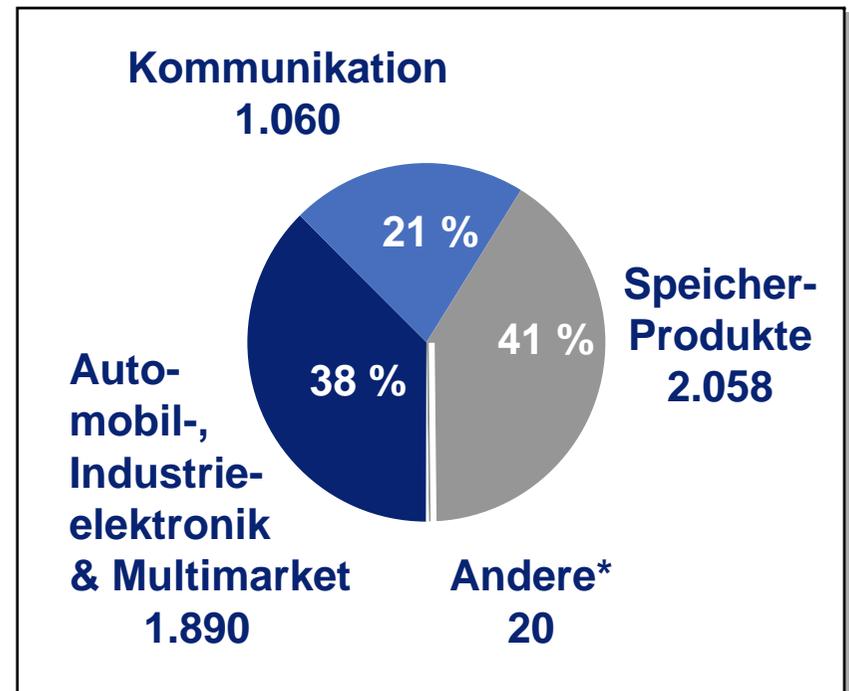
# Umsatzentwicklung nach Segmenten, 9 Monate GJ 2004 und 9 Monate GJ 2005

## 9 Monate GJ 2004



**Gesamt: 5.202 Mio. EUR**

## 9 Monate GJ 2005



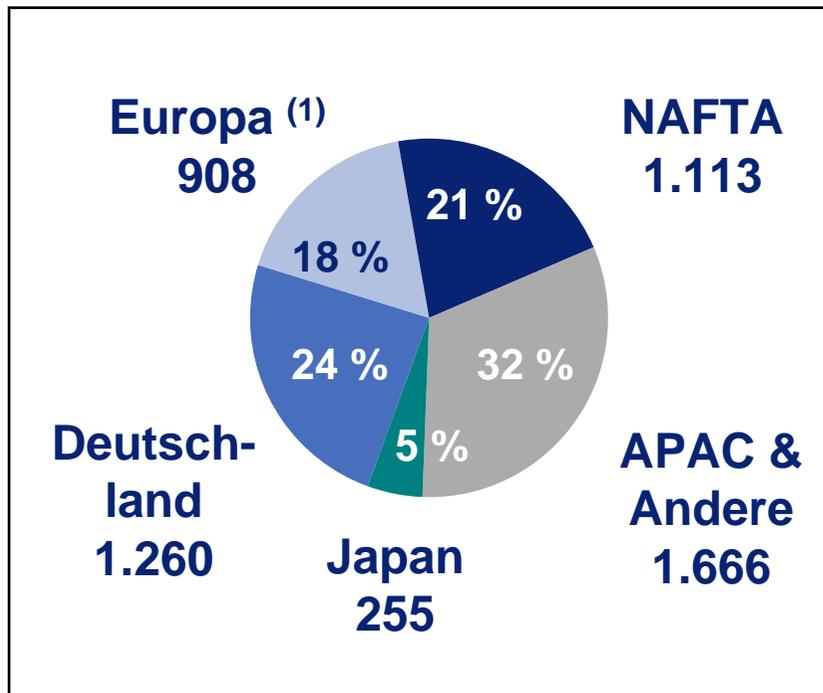
**Gesamt: 5.028 Mio. EUR**

(nach US GAAP)

\* beinhaltet Konzernfunktionen und sonstige Geschäftsbereiche

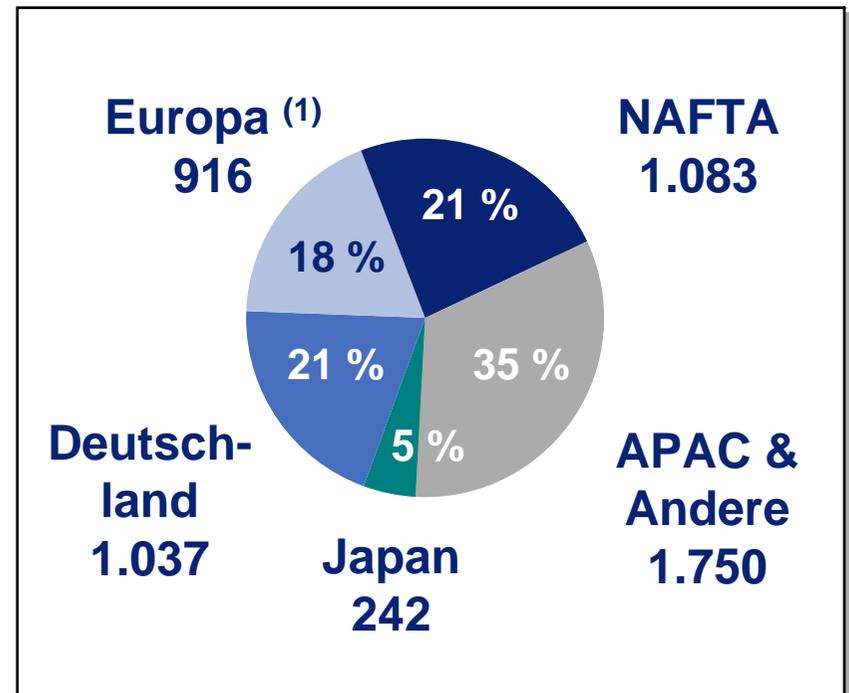
# Umsatzentwicklung nach Regionen, 9 Monate GJ 2004 und 9 Monate GJ 2005

## 9 Monate GJ 2004



**Gesamt: 5.202 Mio. EUR**

## 9 Monate GJ 2005



**Gesamt: 5.028 Mio. EUR**

(1) Ohne Deutschland

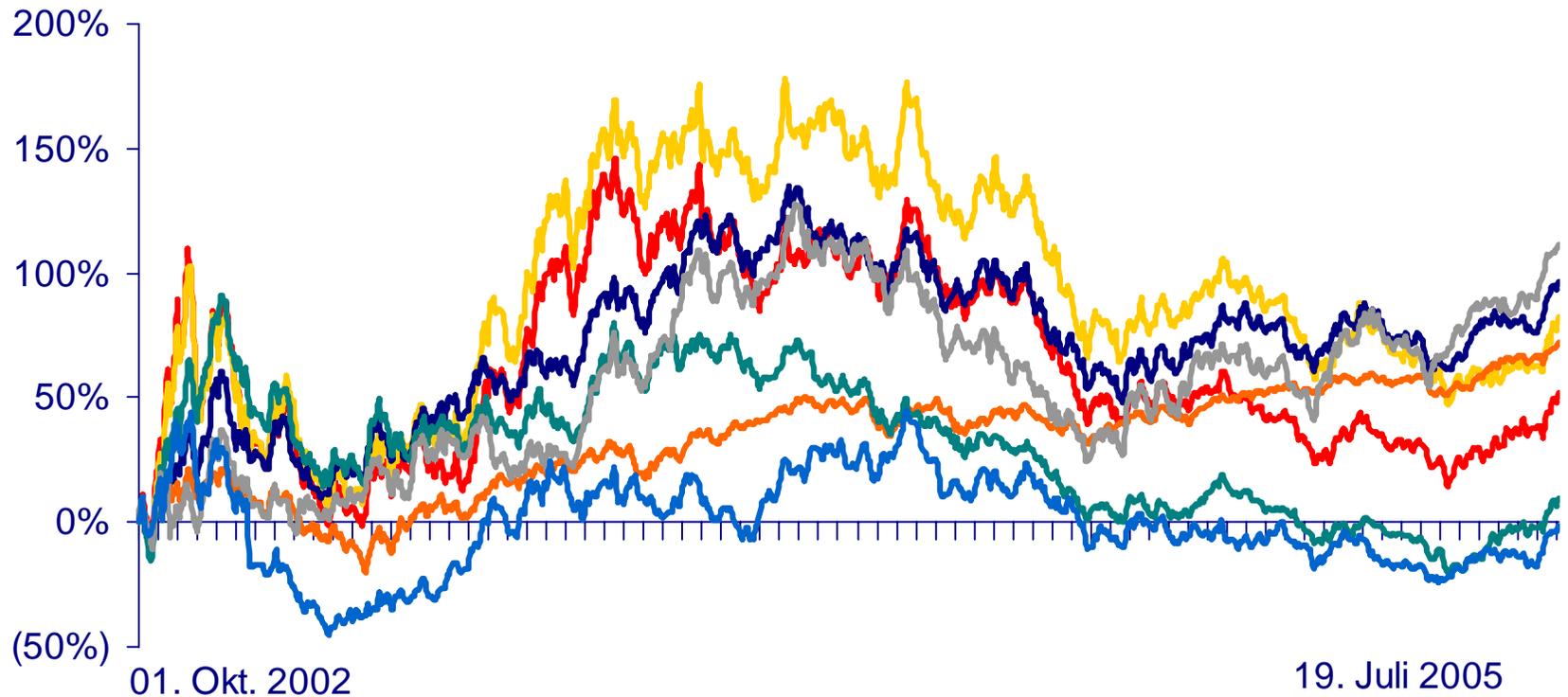
(nach US GAAP)

## Ausblick für 4. Quartal GJ 2005

---

- Insgesamt Erwartung auf ein im Vergleich zu Q3 besseres viertes Quartal.
- Für **AIM** werden stabile Umsätze und EBIT erwartet, auch wenn der Preisdruck vor allem bei Chipkarten-ICs weiter anhält. Auslauf der Produktion in Perlach und Anlaufkosten für die Fabrik in Kulim wirken sich negativ auf EBIT auch in KJ 2006 aus.
- Bei **COM** generell stabile oder leicht höhere Umsätze als in Q3 erwartet. EBIT vorbehaltlich von Sondereffekten stabil oder leicht verbessert gegenüber Q3.
- **MP** geht von weiterer Zunahme der Speicherausstattung pro Rechner, von erhöhter Nachfrage nach Speicherprodukten sowie von nur moderatem Angebotswachstum in Q4 aus. Daher wird ein ausgewogenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage erwartet. Erwartung auf zusätzlichen Marktanteil durch stärker als der Markt steigendes Bit-Volumen aufgrund von kontinuierlich steigenden Kapazitäten bei Joint-Venture- und Foundry-Partnern sowie durch Beginn des Hochlaufs der 300-mm-Fertigung in Richmond. Außerdem plant Infineon, die weitere Diversifizierung seines Portfolios bei Speicherprodukten zur Margenverbesserung und um Preisschwankungen zu reduzieren.

# Relative Performance der IFX-Aktie seit Beginn des GJ 2003



- Infineon Technologies (XETRA)
- Infineon Technologies (New York)
- Micron Technologies
- ST Microelectronics
- Texas Instruments
- SOX
- DAX

---

- Markt
- Unternehmensüberblick
- Mission
- Geschäftsentwicklung 3. Quartal Geschäftsjahr 2005
- **Geschäftsbereiche**
- Allgemeine Unternehmensdaten

# Infineon – Geschäftsbereiche

---

AIM



Automobil-, Industrieelektronik  
& Multimarket

COM



Kommunikation

MP



Speicher-Produkte

# Automobil-Halbleiterlösungen kombinieren

## Datenerfassung, Datenverarbeitung und Ansteuerung

stop thinking  
never

**Erfassen**

**Verarbeiten**

**Ansteuern**

**Antriebsstrang**

- Diesel-Motor-Mgmt.
- Benzin-Motor-Mgmt.
- Getriebesteuerung
- Anlasser / Lichtmaschine



- Drucksensoren
- Hall-Sensoren

- 16 bit  $\mu$ C
- 32 bit TriCore<sup>®</sup> ( $\mu$ C + DSP)

- MOSFETs
- IGBTs
- Regler
- Transceivers
- Smart Power
- System ICs

**Sicherheit**

- ABS / Traktionskontrolle
- Federung
- Airbag + Rückhaltesysteme
- Servolenkung
- Reifendruckmessung



- Drucksensoren
- Hall-Sensoren
- RF ICs

- 8 bit  $\mu$ Cs
- 16 bit  $\mu$ Cs
- 32 bit TriCore<sup>®</sup> ( $\mu$ C + DSP)

- Dioden
- Transistoren
- MOSFETs
- Regler
- Transceivers
- Smart Power
- System ICs

**Karosserie & Komfort**

- Lichtsteuerung
- Heizung, Lüftung, Klimaanlage (HVAC)
- Türen & Sitze
- Intelligente Batterie



- Hall-Sensoren
- Temp.-Sensoren
- RF ICs

- 8 bit  $\mu$ Cs
- 16 bit  $\mu$ Cs

- Dioden
- Transistoren
- MOSFETs
- Smart Power
- Regler
- Transceivers

**Infotainment**

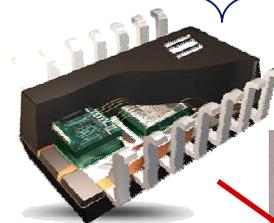
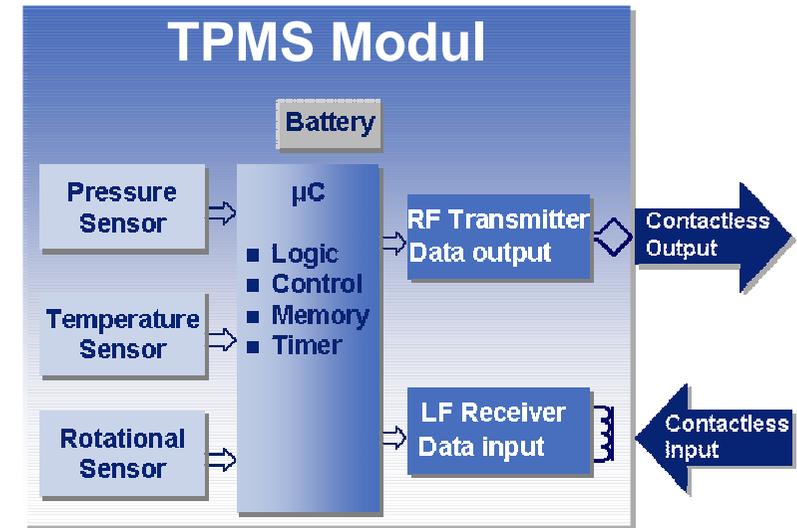
- Telematik
- Navigation
- Multimedia
- Audiosystem
- Armaturenbrett



Mikrocontroller, Lösungen für Langstrecken- (GSM/GPRS) und Kurzstrecken- (Bluetooth, WLAN) Übertragung, GPS, Hochfrequenz-ICs, CAN/MOST Transceiver, Kunststoff-Lichtleiter, Multimedia-Cards, Power ICs, Security ICs

# Sensoren, Controller und RF ICs für Reifendruck Mess-Systeme (TPMS)

- Infineon kombiniert seine Kompetenzen in drahtloser Kommunikation und Automobilelektronik für eine führende Position im Bereich Reifendruck Messsysteme
- Die Lösungen beinhalten hauptsächlich:
  - Technisch führende Druck-, Temperatur- und Rotationssensoren
  - Hochleistungs-Mikrocontroller
  - Breites Portfolio an Sendern und Empfängern
- Unsere Kernkompetenzen bei Sensoren:
  - Hochentwickelte Signalverarbeitung
  - Langjährige technische Unterstützung
- Schlüsseltrends für Sensoren:
  - Weitere Funktionsintegration durch fortgeschrittene Signalverarbeitung
  - Erhöhte "Robustness"
  - Standardisierte Konzepte zur Signalweiterleitung



# Energie steuern mit Leistungshalbleitern, -modulen und Microcontrollern

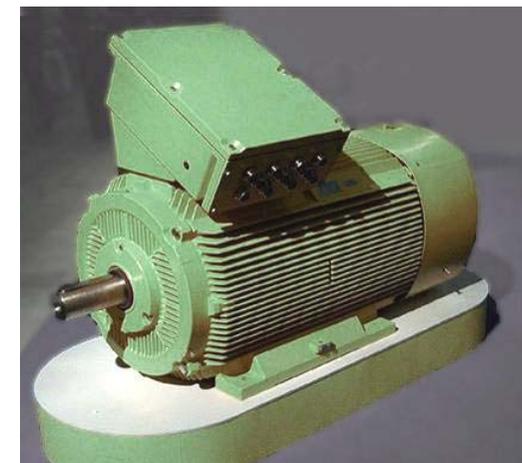
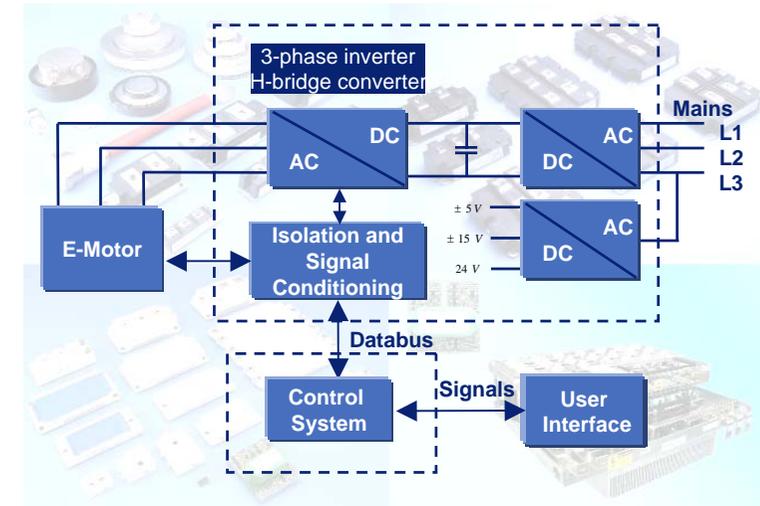
stop thinking never

|  |  | Power Discretes   | Power Modules   | Power ICs   | Micro-controllers  |
|--|--|---|---|---|--|
| <b>Dezentrale Energieversorgungssysteme</b><br>                           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thyristoren &amp; Dioden</li> <li>PressPACK</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>EasyPIM™</li> <li>EasyPACK™</li> <li>EconoPACK™</li> <li>IHM Module</li> <li>BIP Module</li> <li>Stacks</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>EiceDrive™</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>8-bit <math>\mu</math>Cs</li> <li>16-bit <math>\mu</math>Cs</li> <li>32-bit TriCore® (<math>\mu</math>C + DSP)</li> </ul> |
| <b>Automatisierung / Antriebe</b><br>- Industrie<br>- Haushaltsgeräte<br> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>EmCon™</li> <li>Trench Stop IGBTs</li> <li>Fast IGBTs</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>EasyPIM™</li> <li>EasyPACK™</li> <li>EconoPACK™</li> <li>IHM Module</li> <li>BIP Module</li> <li>Stacks</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PWM &amp; PFC ICs</li> <li>EiceDrive™</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>8-bit <math>\mu</math>Cs</li> <li>16-bit <math>\mu</math>Cs</li> <li>32-bit TriCore® (<math>\mu</math>C + DSP)</li> </ul> |
| <b>Traktion</b><br>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thyristoren &amp; Dioden</li> <li>PressPACK</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>IHM / IHV Module</li> <li>Stacks</li> <li>PrimePACK™</li> <li>62mm IGBT Module</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>EiceDrive™</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>8-bit <math>\mu</math>Cs</li> <li>16-bit <math>\mu</math>Cs</li> <li>32-bit TriCore® (<math>\mu</math>C + DSP)</li> </ul> |
| <b>Netzgeräte</b><br>- UPS<br>- AC / DC<br>- DC / DC<br>                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>CoolMOS™</li> <li>thinQ!™ (SiC Schottky Diode)</li> <li>Highspeed IGBTs</li> <li>OptiMOS®</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>EasyPIM™</li> <li>EasyPACK™</li> <li>IsoPACK™</li> <li>EconoPACK™</li> <li>Thyristor- / Dioden-Module</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PWM &amp; PFC ICs</li> <li>CoolSET™</li> <li>Integrierte Schalter</li> <li>Gate drivers</li> <li>EiceDrive™</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8-bit <math>\mu</math>Cs</li> <li>16-bit <math>\mu</math>Cs</li> </ul>  |

# Industrielle Antriebe

## Leistungen von 100 W bis 4 MW

- Nr. 1 weltweit in Standard IGBT-Modulen
- Nr. 3 weltweit in Halbleitern für Antriebe
- Produktportfolio umfasst die gesamte Applikation: Leistungshalbleiter, Gleichrichter, IGBT Module, Controller, optische POF Transceiver
- Umrichterlösungen für alle Leistungsbereiche
- IGBT- / BIP-Baugruppen mit Treibern und Regelkreisen
- Umfangreiches Portfolio an Mikrocontrollern mit exzellentem Echtzeitverhalten und Peripherie zur Antriebssteuerung (PWM, ADC, Timer etc.)
- 16- & 32-bit Mikrocontroller mit DSP Verarbeitungsleistung
- TriCore™ basierte 32-bit Mikrocontroller und IGBTs der dritten Generation erlauben leistungsfähigste Systemlösungen für Antriebe



# Chipkarten und Sicherheitsanwendungen

## Infineon ist gut positioniert für die wichtigen Wachstumsmärkte

**Kontakt basierte  
Chipkarten**

**Kontaktlose  
Chipkarten, RFID**

**Sicherheits ICs**



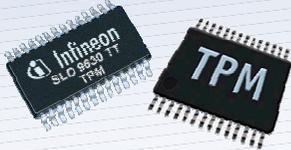
**Kommunikation**  
Telefonkarte  
Handykarte



**Bezahlung**  
Kreditkarte, Geldkarte  
Transport, Tickets



**Identifizierung**  
Elektronischer Pass,  
Ausweis, Wahlschein,  
Sozialversicherung, RFID



**Unterhaltung**  
Pay-TV, Spiele,  
Video/Audio



stop thinking  
never

# Herausforderungen & Entwicklungen im Bankensektor

## Chipkartenlösungen für Sicherheit im Finanzverkehr

Bedarf nach Sicherheit durch Chipkarten

### Ersatz von Magnetstreifenkarten

Minimalanforderung nach EMV von VISA und Mastercard



### Mehrwert für Banken und Konsumenten

Kontaktlose Interfaces für Komfort / Personenverkehr  
EMV DDA, Bürgschaften, Geldkarte, etc.

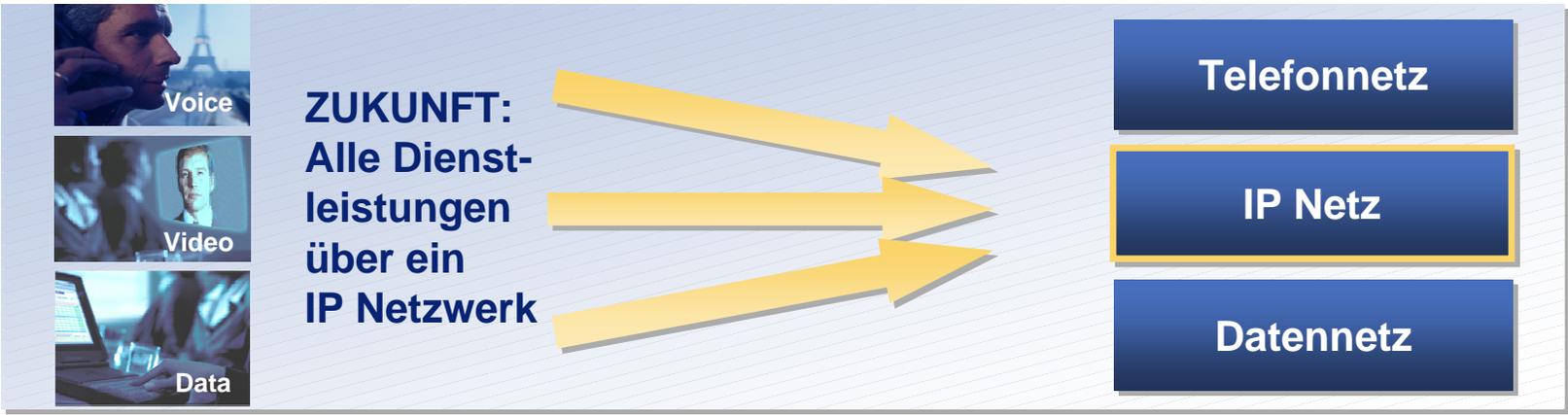


### Banken werden die Vertrauenszentren von morgen sein

Sicheres Home Banking  
PKI / Digitale Unterschrift als Dienstleistung der Bank  
(z. B. als Sozialversicherungsschein oder Personalausweis)



# Wir treiben die Konvergenz von Sprache, Video und Datenkommunikation voran



## Abhängig von den Anforderungen der Anwender

- Bandbreite
- Reichweite
- Kosten
- Flexibilität
- Verlässlichkeit
- Energieverbrauch

stop thinking never

# COM Business Units – treiben die Konvergenz der Kommunikationstechnologien voran

## Broadband Access

Access  
CPE



- Komplettes xDSL CO / CPE Portfolio
- Eine Chipset Familie für alle VoIP Applikationen
- Referenz Designs für ADSL2+ Router, VoIP Router und IP Telefone
- Chipsets für T/E Carrier, Analog Linecards und ISDN

## RF Connectivity

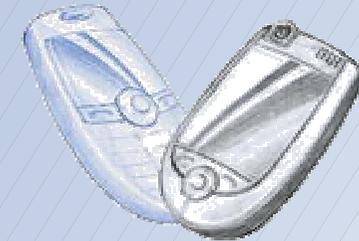
RF Engine, RF Power,  
Tuner System, RF Custom,  
SR Wireless



- RF Transceiver und BAW Filter für 2G und 3G Mobiltelefone und drahtlose Datenmodule
- Power Amplifier und RF ASIC für 2G und 3G Basisstationen
- Bluetooth EDR, A-GPS und WLAN Verbindungs-lösungen
- DECT/WDCT Chipset
- Analoge und digitale erdgebundene Tuner Systeme

## Mobiltelefone

Entry Phone, Feature  
Phone, CP Siemens,  
Software



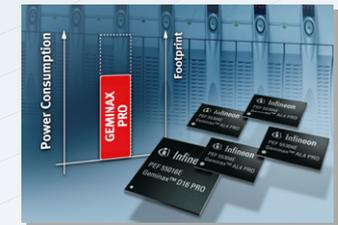
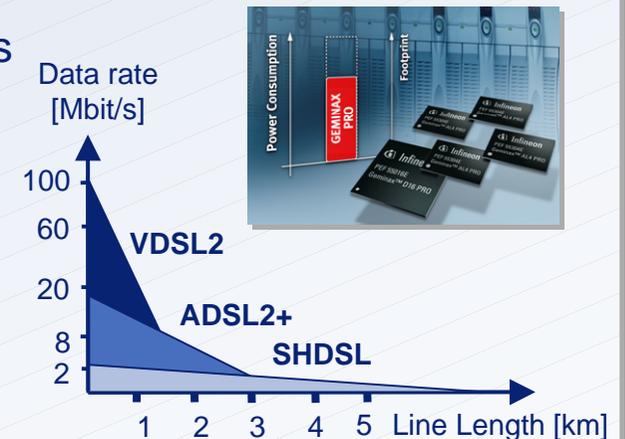
- Referenz Designs für GSM/GPRS, EDGE und UMTS Standards
- RF / Basisband Single-Chip und Multimedia Basisband SoC
- Protocol Stack und Application Framework Software

stop thinking  
Never

# Broadband Access Schwerpunkte

## Access

- Führende Marktposition in Standard-Telekommunikations-Infrastruktur\*: Nr. 1 in T/E Carrier, No. 1 in Analog Linecards
- Komplettes xDSL CO / CPE Portfolio:
  - Starker Gewinn an Marktanteilen in ADSL/2/+
  - Industrieweit erster Standard Compliant VDSL2 ICs
  - Führende Position in SHDSL und VDSL
- Erste integrierte Sprach- / Daten-Lösung (IVD) mit eingebauter Splitter- u. VoIP-(Voice over IP)-Funktion
- Signifikante Weiterentwicklung von Infineon basierten ADSL2+ DSLAMs und frühzeitige Verfügbarkeit des ADSL2+ Modem Chipsets
- VoIP und IP Telefon Lösungen in Spitzenqualität



## CPE (Customer Premise Equipment)

- Eintritt in den "Digital Home"-Markt durch die Kombination von Infineon's DSL- u. Sprachlösungen mit ADMtek's "Home Router"-Technologie u. Marktposition
- Große Bandbreite an drahtgebundenen und drahtlosen Lösungen. Netzwerkprozessoren, NICs, Switches und Router, Produktportfolio



# Broadband Access Produkt Portfolio

## Applikationen

## Produktmerkmale



DSLAM / DLC  
IVD line-cards



Zellulare  
Basisstationen



- Ultra low power ADSL2+
- Fully standard compliant VDSL2




Video  
Phone



Media  
Adapter



Home Gateway

- Zukunftsweisende System-on-chip Lösungen
- Hoher Integrationslevel
- Multiple Schnittstellen für eine Vielzahl an Anwendungen
- Komplette System Designs




IP Telefon



VoIP and POTS  
line cards

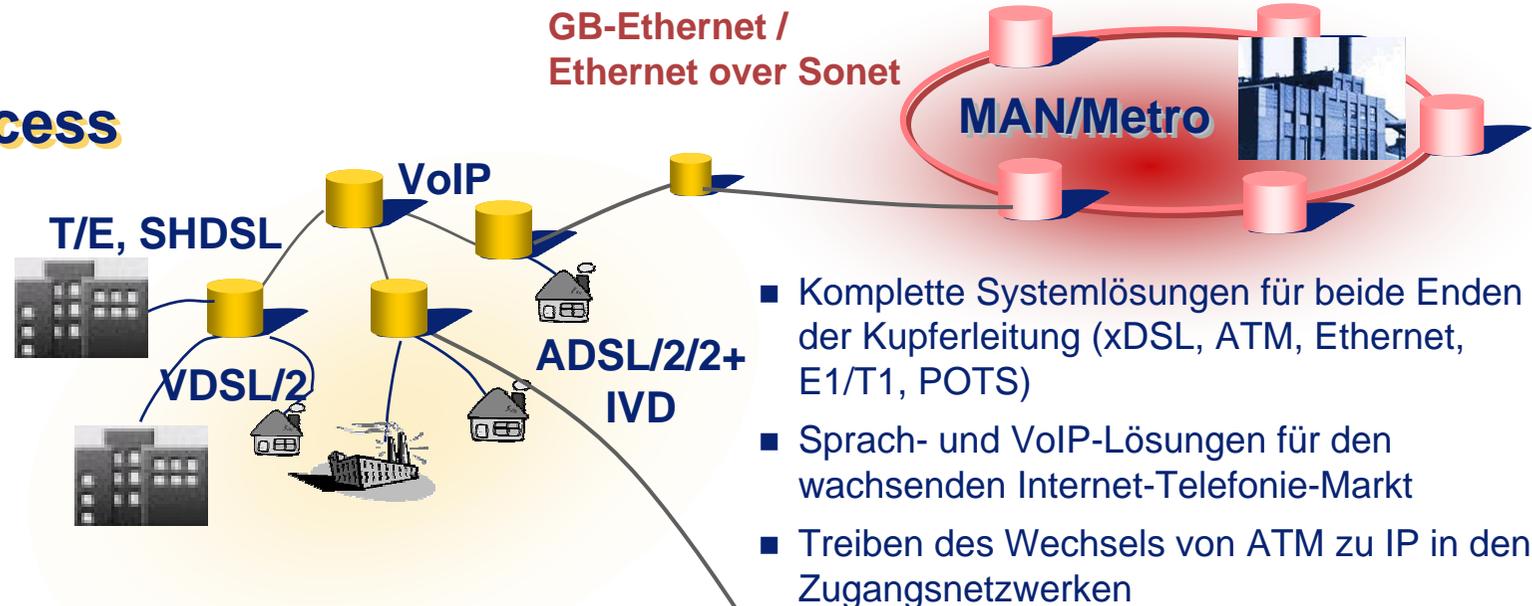


- Komplette IP Telefonie SW / HW-Pakete
- Skalierbare Lösungen, die die Anforderungen aller Länder erfüllen.



# Broadband Access – Durchgehende Broadband Access und CPE Lösungen

## Access



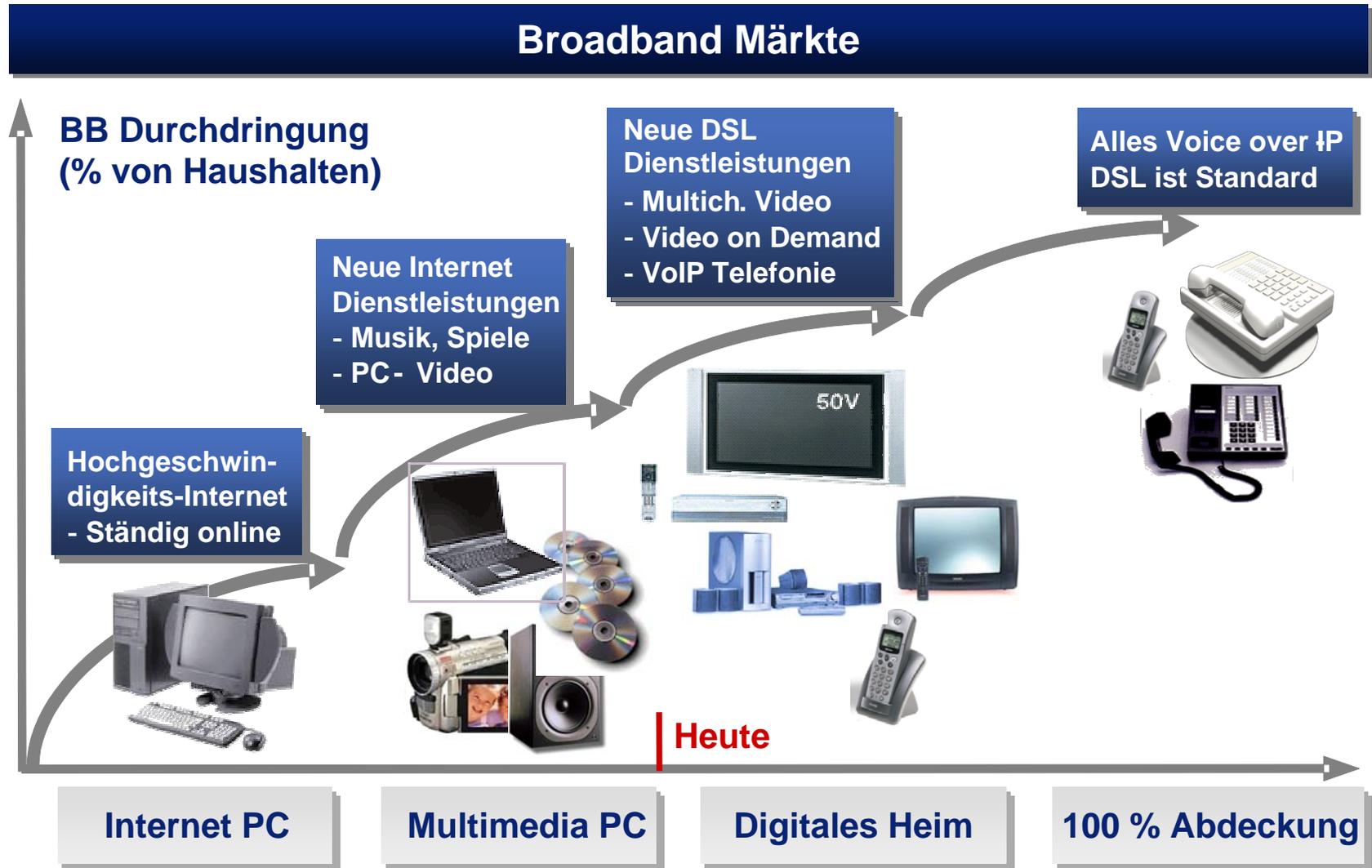
- Komplett Systemlösungen für beide Enden der Kupferleitung (xDSL, ATM, Ethernet, E1/T1, POTS)
- Sprach- und VoIP-Lösungen für den wachsenden Internet-Telefonie-Markt
- Treiben des Wechsels von ATM zu IP in den Zugangsnetzwerken

- Umfassendes Produktportfolio für alle Customer-Premises-Equipment(CPE)-Applikationen einschließlich xDSL-Router mit WLAN Option, VoIP Schnittstelle, Speicherschnittstelle und Multimedia-Applikationen
- Komplett, voll-funktionsfähige Referenz Designs für eine Vielzahl von CPE-Applikationen



# Broadband Access - DSL Halbleitermarkt

## Wachstum ist stark getrieben durch Voice-over-IP (VoIP)



# RF Connectivity Schwerpunkte

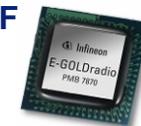
## RF Engine

- GPRS / EDGE: Niedrigkosten-Lösung durch Infineon RF CMOS sowie "3rd party" Power Amplifier und Frontend
- CDMA 2000: weltweit 1. Single-Chip CMOS RF SMARTi CD für CDMA 1X
- Multimode UMTS/EDGE: skalierbare RF Engine-Lösung entspricht multiband WDCMA Anforderungen
- Vollständiges Radio Module: RF Engine-Module benützen CMOS RF in Kooperation mit einem Partner
- GPRS: weltweit erster CMOS Single Chip BB+RF EGOLDradio

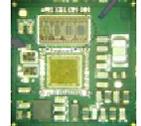
RF Engine



Monolithic BB+RF



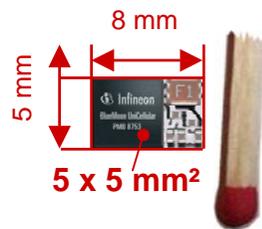
RF Module



## Short Range Wireless

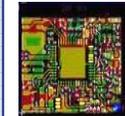
- Führende Position in DECT/WDC. Entwicklung neuer CMOS Single-Chip
- Starke Position in Bluetooth mit neuer erweiterter Datenraten-Lösung
- "Hammerhead": erster CMOS Single-Chip A-GPS Lösung in Kooperation mit Global Locate
- Entwicklung von Low Power WLAN Lösungen für mobile Anwendungen

Bluetooth



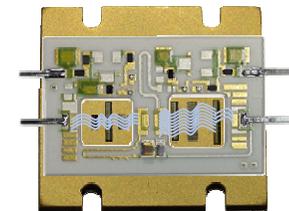
## Tuner Systems

- Führend im terrestrischen Marktsegment mit dem digitalen Tuner "TUA6034"
- Fokus auf portable und mobile Segmente mit neuen Low power digital Tunern für Laptop / PC und Mobiltelefonanwendungen mit TUA6041 ("alignment free") und TUA6045
- Fortsetzen der Lieferung und des Services des analogen Tuner Marktsegments



## RF Power

- Weitreichendes Produktangebot für Funkbasisstationen einschließlich RF Modulen, RF ICs und RF Power Transistoren & Module
- Nr. 2 in High Power RF Transistoren
- Neueste RF Power LDMOS Technologie und thermisch verbessertes Packaging



## Applikationen

**RF engine** PC Karten



Mobiltelefon



Bluetooth  
WLAN  
GPS  
DECT



**Tuner** Setup  
box



PDA



Car TV



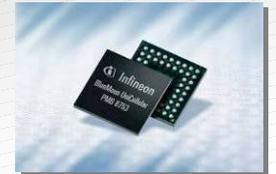
**RF- Power Amplifier**  
Zellulare Basisstationen  
Broadcast  
Wi-Max

## Produktmerkmale

- FTA konforme RF Engines
- Führendes RF CMOS Transceiver Portfolio für alle Standards von mobilen Systemen
- Höchster Integrationsgrad + niedrigste Bill of Material (BOM)



- Bluetooth CMOS-single Chip für erweiterte Datenrate
- Low power sprachzentrierte WLAN Lösungen für Telefone
- Voll integrierte CMOS Lösung für GPS-A
- Step 8 erweiterte Featuresets gefolgt von DECT Single-Chip



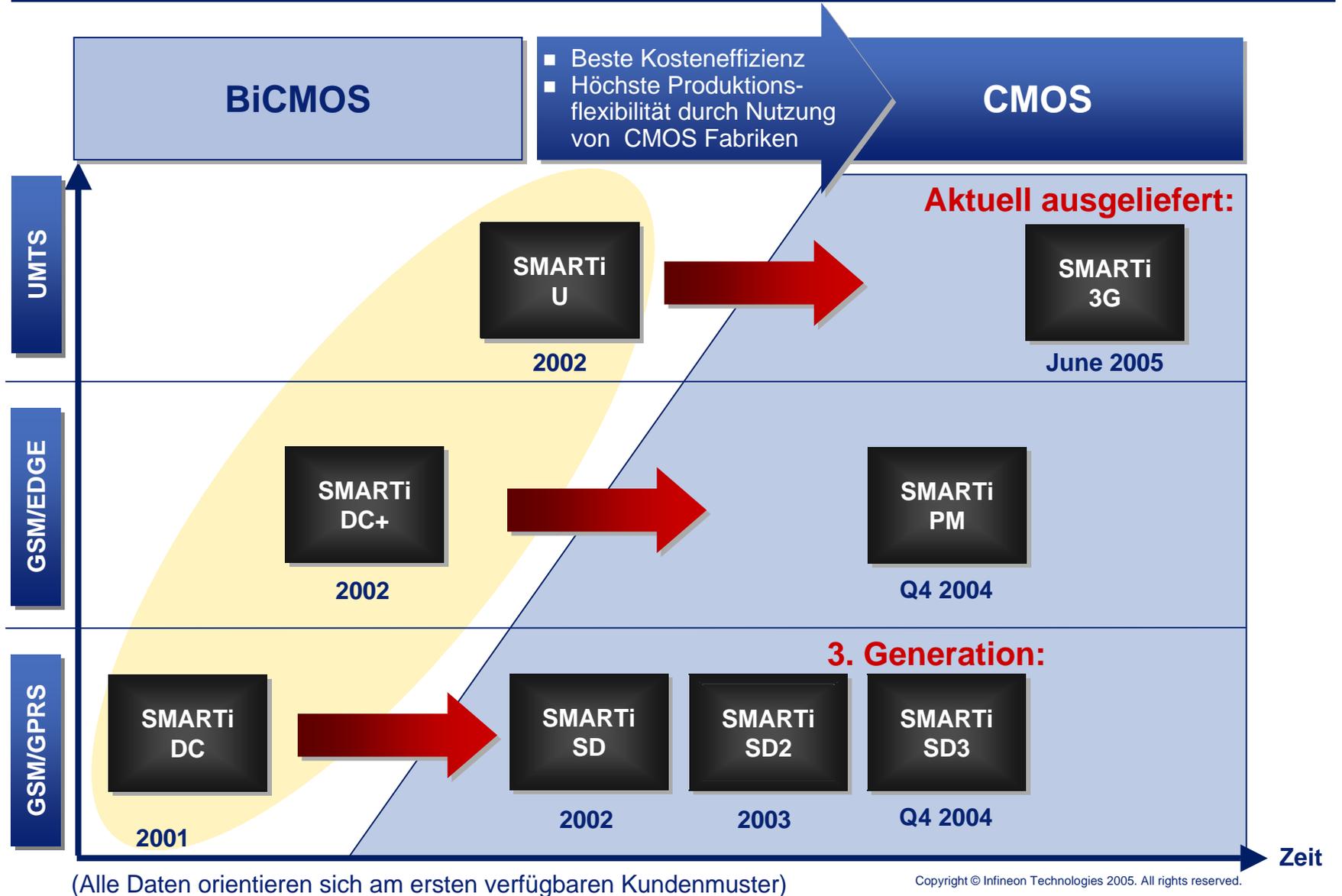
- Tuner ICs für stationären, portablen und mobilen TV-Empfang
- Analogere und digitaler Kabel-/ terrestrischer TV-Empfang
- Analoge (PAL, NTSC) und digitale (DVB-C/T, ISDB, ATSC, DAB) TV Standards
- Niedrige Spannung und niedriger Energieverbrauch
- Digital China Terrestrial, T-DMB Standards im Focus

- Leistungsstufe von 10 W bis 300 W
- Frequenzen von 450 MHz bis 2700 MHz
- Keramik- und Plastikgehäuse



# RF Connectivity

## Führend im Übergang von RF Transceivern zu CMOS



# CMOS RF – Weg zu höchster Integration – Monolithische Integration von Basisband & CMOS RF Transceivern

2004

## RF CMOS Transceiver:

- In Volumen-Produktion
- 130 nm CMOS
- Single-Chip digital RF Lösung

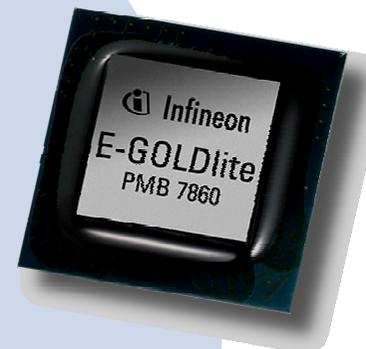
## Baseband:

- In Volumen-Produktion
- 130 nm CMOS
- Integriert:
  - Digital Basisband
  - Mixed Signal
  - SRAM



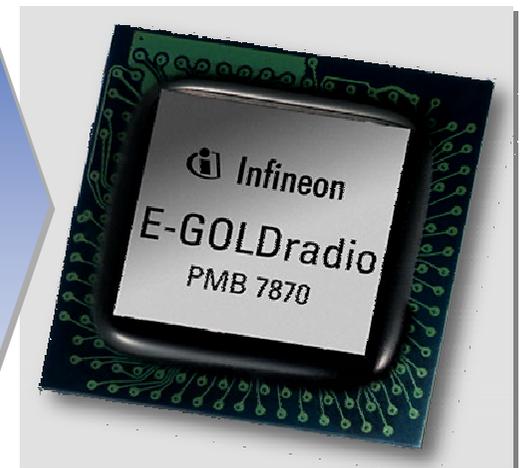
## Kunden Vorteil:

- Niedrigere Systemkosten
- Kleinerer PCB Bereich
- Weniger Komplexität



2005

## Single-Chip: RF und Basisband



stop thinking  
never

# Mobiltelefon Produktportfolio

## Applikationen

## Produktmerkmale

**SMART  
Phones**  
Open OS



- Video Konferenzen / Video Streaming
- Video Aufnahmen mit Vorschau-Modus
- High-speed Internet-Zugang
- 3D sound / 3D Spiele
- Erweiterte J2ME Features
- UMTS Empfangsvielfalt



**MultiMedia  
Phones**  
MP-E/U  
Camera



- 2 MPix Standbildkamera
- Video Wiedergabe / Aufnahme
- Video Streaming w/o companion
- MPEG4, H.263, MP3, AAC++
- Sprachaufzeichnung / -erkennung

**Low-End  
Feature Phones**  
MP-1G  
Apoxi



- VGA Kamera Modul
- Polyphone Klingeltöne: bis zu 40 Stimmen
- Video: MPEG-4/H.263 Wiedergabe / Aufnahme
- Codecs: FR / HR / EFR / NB-AMR
- Verbindungsfähigkeit: IrDA, USB 2.0, Bluetooth



# Mobiltelefon – Infineons ULC Plattformen entsprechen allen Anforderungen des Marktes



# Infineons Beitrag: ULC Plattform ermöglicht Mobiltelefone günstiger 20 USD

## Kosten der Komponenten



- **Höchster Grad der Integration Single-Chip E-GOLDRadio**
- **Optimierung externer Komponenten**
  - Minimum an Speicher: nur 2 MByte Flash
  - Unterstützt Standard Ni-MH AAA-Zellen
  - Kombiniertes Kopfhörer- / Ladeanschluss
  - 4-layer PCB
  - Lineares Ladegerät

## Produktionskosten

- Geringe Komponentenzahl – von weniger als 100 Komponenten auf PCB
- Verkürzung der Produktionszeit: Single-sided mounted PCB
- Reduzierung der Testzeit: Zeit für Kalibrierung reduziert von 60s to 1s
- Niedrigste "field-return rate"

## Optimierte Gesamtkosten

## R&D Kosten

- Stabile und ausgereifte E-GOLDRadio Plattform
- Umfassende Entwicklungs- & Supportwerkzeuge
  - Graphische MMI mit schmaler Speicher Anschlussfläche
  - Unterstützt unicode, bi-directional basierte Sprachen und Dialekte

## Portfolio Kosten

- Unterschiedliche Speicher Optionen für
  - Farbdisplay Unterstützung
  - Klingeltöne, Personalisierung
  - Sprachen
- Migration zu Entry Phone Plattform BP3 und nächste Generation ULC Plattformen

# Starke Verpflichtung für den Kundenerfolg

## Kundenverpflichtung

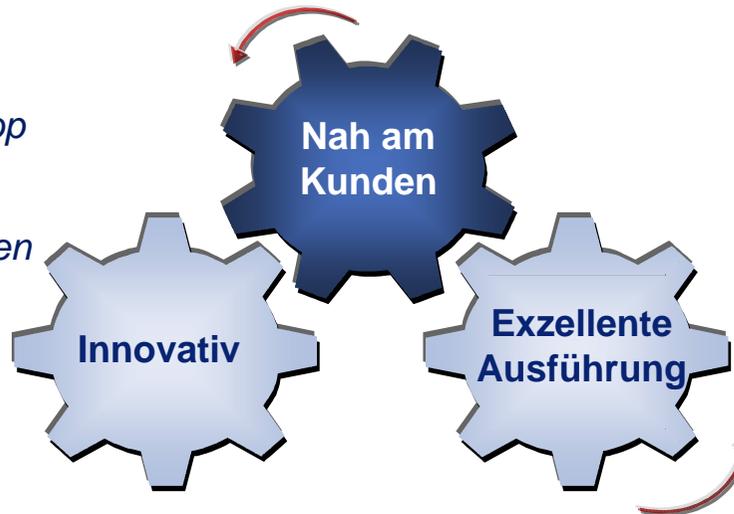
*Wir erreichen zukunftsfähigen Erfolg durch Partnerschaften mit unseren Kunden*

- Top 3 Position im weltweiten Markt für Sprach- und Datenzugang über Kupferinfrastruktur befähigt Kunden zu expandieren und in Zugang und Breitband CPE erfolgreich zu sein
- Führende Position bei drahtloser Kommunikation (RF + GSM/GPRS Basisband)
- Fokussiertes Investment in strategischen Geschäftsfeldern

## Produktinnovation

*Wir arbeiten zusammen mit den Top Industriespielern und -organisationen, um Best-in-Class Lösungen zu kreieren*

- Innovatives, leistungs- / kosteneffizientes xDSL, ATM, Ethernet, VoIP, analog Sprachportfolio
- Industrieführende RF Chips / Chipsets, integrierte Plattformlösungen (Ein-Chip-Telefone)
- Weltweite Präsenz von COM Designressourcen

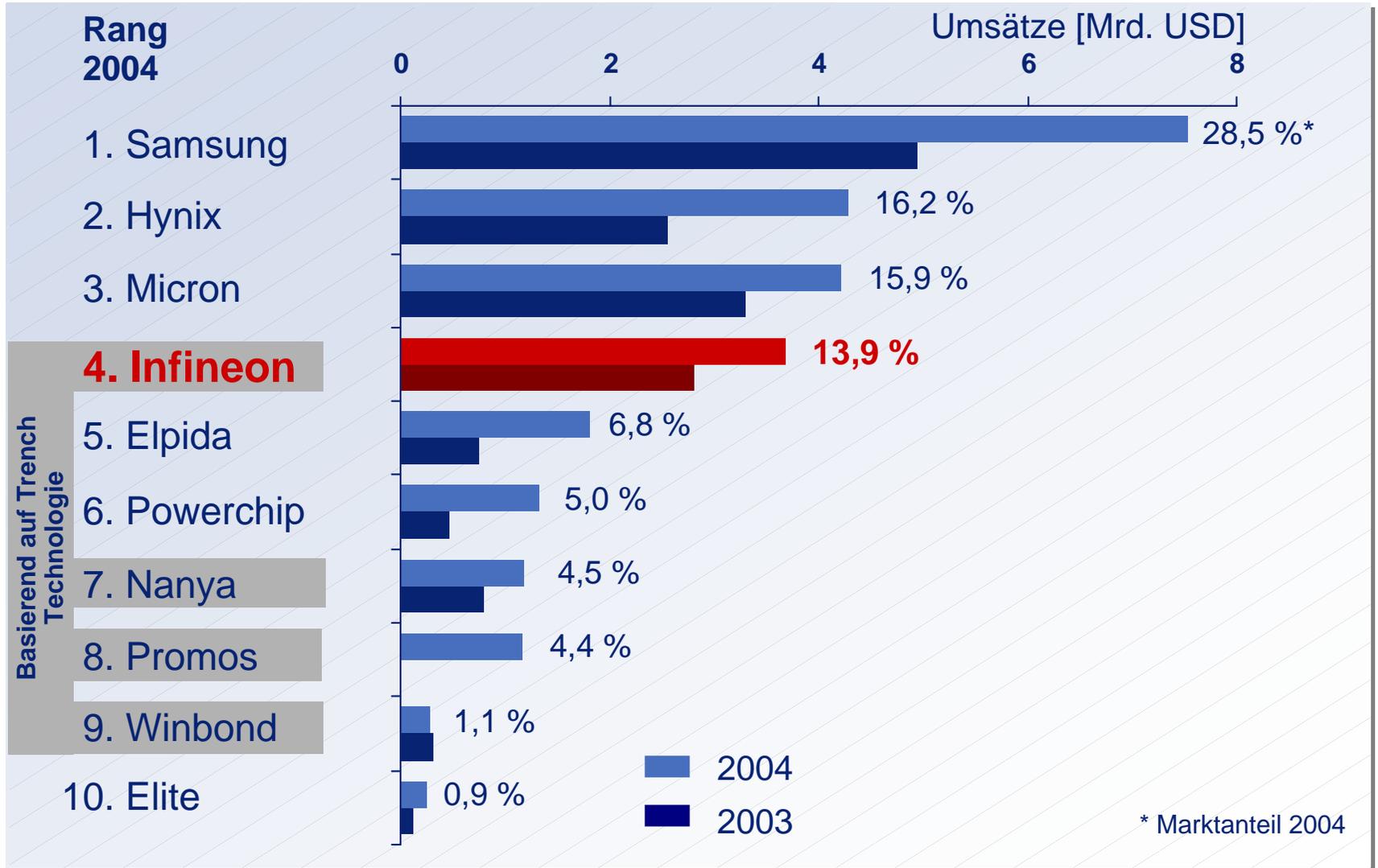


## Exzellente Ausführung

*Wir decken die komplette Halbleiterwertschöpfungskette ab und garantieren maximale Flexibilität in Entwicklung und Produktion*

- Tiefes Verständnis und Know-how bezüglich der Komplexität von Daten / Sprache / Video über Kupferdrahtinfrastruktur
- Best-in-Class Kostenposition bei RF CMOS
- Software / Hardware Integration IP und Systemwissen

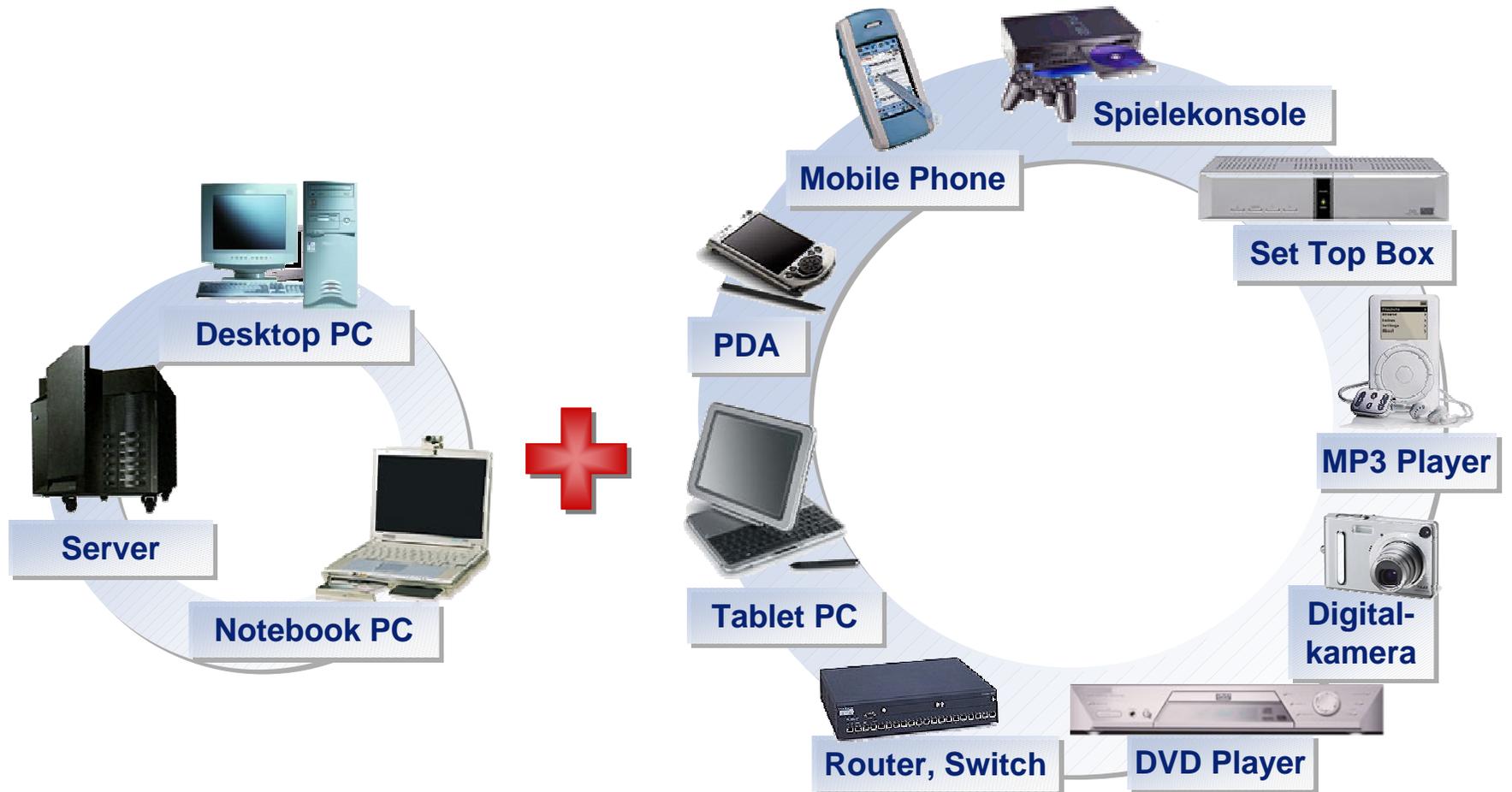
# Weltweite DRAM Rangliste nach Umsatz 2004 und 2003



Quelle: iSuppli, März 2005

stop thinking  
never

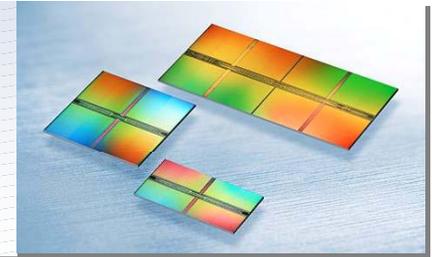
# Der Speichermarkt – Neue Anwendungen



# MP – Stärken

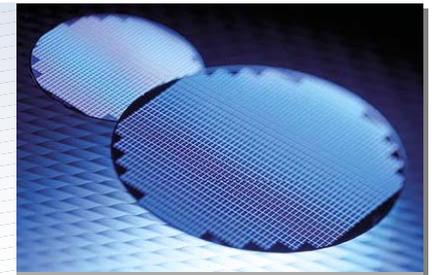
## Führend in Technologie

- Serienproduktion mit 90-nm-Technologie begonnen: 512M DDR und 512M DDR2 Produkte verfügbar
- Erste Prototypen auf 70-nm-Technologie gefertigt



## Führend in Fertigung

- Stark erweiterter globaler Fertigungs-Cluster
- Führend bei der Fertigung auf kosteneffizienten 300-mm Scheiben



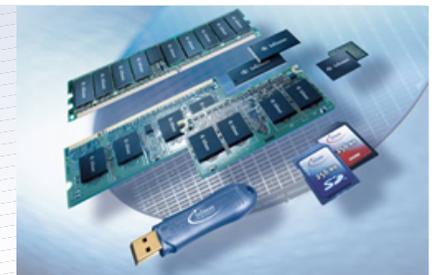
## Starke Technologie- und Fertigungspartnerschaften

- Gemeinsame Technologieentwicklung zur Verbesserung der Skaleneffekte
- Verbesserung der Marktposition mit reduzierten Kapitalanforderungen
- Flexible Aufstockung der Kapazitäten durch Vertragsfertiger



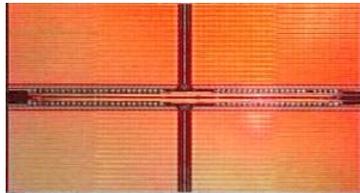
## Erweiterung des Produktportfolios

- Erweiterung des Modulportfolios für Mobile PCs und Infrastruktur
- Zunehmender Fokus auf Consumer und Spezial DRAMs
- Um NAND-kompatiblen Flash erweitertes Produktportfolio



# DRAM Technologie Roadmap

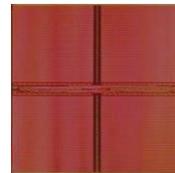
2004 – 110 nm



256M DDR 110 nm

- Erste DRAM Technologie unter Einsatz von 193-nm-Lithographie

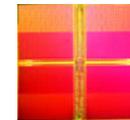
2005 – 90 nm



512M DDR 90 nm

- Schlüssel Innovationen: 'Bottle shaped trench' Neues Zellenlayout
- Serienfertigung in Q2 2005 begonnen

2006 – 70 nm



512M DDR2 70 nm

- Erste Prototypen auf 300-mm verfügbar

# DRAM Fertigungs-Cluster

## DRAM Fertigungs-Cluster

**Frontend**

|                         |                          |                   |              |              |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                         |                          |                   |              |              |
| Dresden<br>200 + 300 mm | Richmond<br>200 + 300 mm | Inotera<br>300 mm | 200 + 300 mm | 200 + 300 mm |

**Identische Technologie Roadmaps**

**Globale Prozesssynchronisation und Qualitätskontrolle**

**Best Practice Sharing und schnelle Hochläufe**

**Backend**

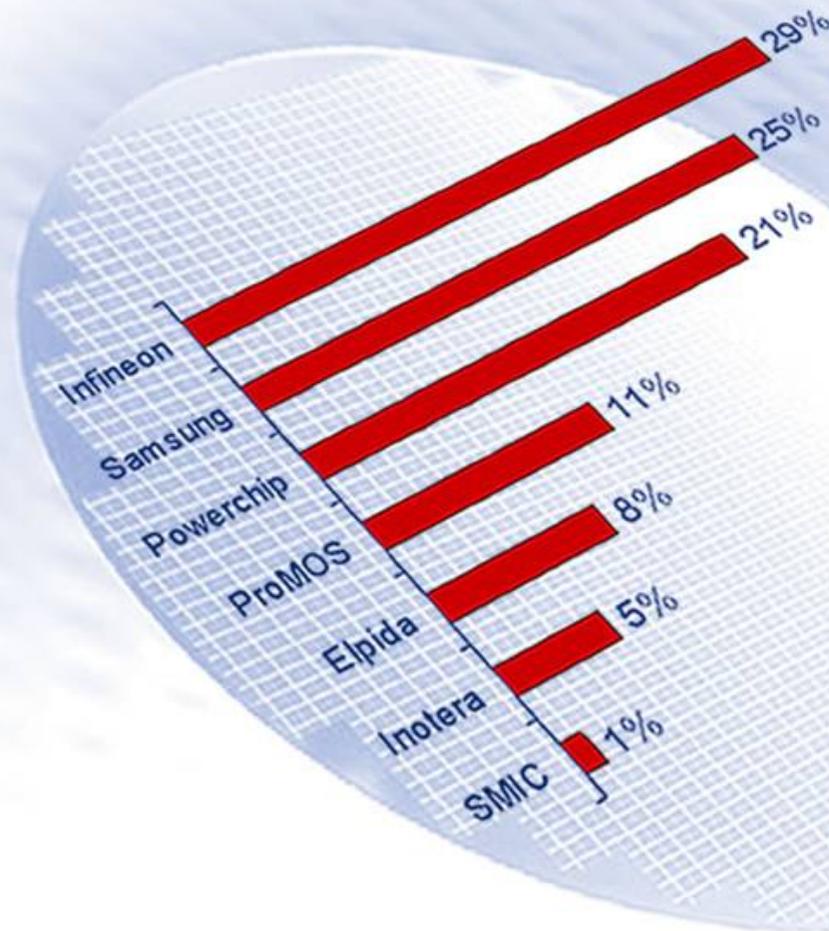
|         |       |         |        |  |  |  |
|---------|-------|---------|--------|--|--|--|
|         |       |         |        |  |  |  |
| Dresden | Porto | Malacca | Suzhou |  |  |  |

**Eine (virtuelle) Fertigung zum Kunden**

stop thinking  
never

## Führend in 300-mm-DRAM-Fertigung

### Marktanteil an der 300-mm-Produktion im Jahr 2004



# Die Organisation des Bereichs Speicher-Produkte: Fokus auf Anwendungen und Marktsegmente

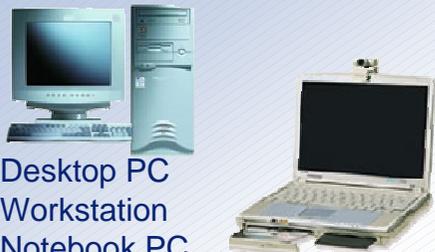
| Business Units      | Computing  | Graphics  | Consumer & Mobile  | <br>Simply advanced       | Flash   |
|---------------------|--|---|--|--|---|
| Anwendung (Auswahl) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desktop PC</li> <li>■ Notebook PC</li> <li>■ Server</li> <li>■ Workstation</li> <li>■ Storage</li> <li>■ Netzwerke</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Graphik</li> <li>■ Spiele Konsolen</li> <li>■ Tragbare Computerspiele</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mobiltelefone</li> <li>■ Set-Top-Box</li> <li>■ DVD Player &amp; Rekorder</li> <li>■ Digitalkameras</li> <li>■ MP3 Player</li> <li>■ Auto Navigation</li> <li>■ PDA</li> <li>■ Digital TV</li> <li>■ Peripherie-Geräte</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desktop PC</li> <li>■ Notebook PC</li> <li>■ Workstation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mobiltelefone</li> <li>■ Digitalkameras</li> <li>■ MP3 Player</li> <li>■ USB Drive</li> <li>■ PDA</li> <li>■ Flash Karten</li> </ul> |
| Treiber             | Ersatzinvestition<br>Leistung<br>Internet<br>Infrastruktur<br>Bandbreite<br>Data Warehouse   | Leistung<br>Digital Lifestyle<br>3D Bilder<br>Neue Spiele   | Mobilität<br>Digital Lifestyle<br>Low-Power<br>Info Mgmt.<br>Content<br>Download   | Leistung<br>Emerging markets<br>White boxes  | Datenspeicher<br>Digital Lifestyle<br>Mobilität   |

# Computing Portfolio

## Anwendungen



Router, Switches



Desktop PC  
Workstation  
Notebook PC  
Sub-Notebook PC



High-End Workstation  
Server

## Produkteigenschaften

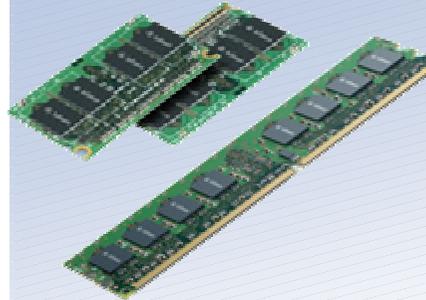
### DRAM Komponenten:

- Schnittstellen: SDR, DDR, DDR2
- Dichten: 128 MB – 1 GB
- Organisationen: x4, x8, x16
- Gehäuse: TSOP, FBGA
- Geschwindigkeit: PC133 – DDR2-533



### Unbuffered und SO-DIMMs:

- Schnittstellen: SDR, DDR, DDR2
- Formfaktor: Unbuffered, SO-DIMM, MicroDIMM
- Dichten: 128 MB – 2 GB
- Geschwindigkeit: PC2100 – PC2-4200



### Registered Module:

- Schnittstellen: SDR, DDR, DDR2
- Formfaktor: Registered, FB-DIMM
- Dichten: 128 MB – 4 GB
- Geschwindigkeit: PC2100 – PC2-4200



# Graphik Portfolio

| Graphik Segment          | Eigenschaften  | Produkte   |
|--------------------------|--|--|
| <p><b>High end</b></p>   | <p>Hohe Geschwindigkeit:<br/>500 – 800 MHz<br/>Hohe Bandbreite: x32<br/>Niedriger Stromverbrauch</p>                 |  <p>512M &amp; 256M GDDR3</p> |
| <p><b>Mainstream</b></p> | <p>Erhöhte Geschwindigkeit:<br/>300 – 500 MHz<br/>FBGA Gehäuse<br/>Bandbreite: x16<br/>Arbeitsspannung 1,8V-2,0V</p> |  <p>256M DDR2 (+512M)</p>     |
| <p><b>Value</b></p>      | <p>Standard Geschwindigkeit:<br/>200 – 300 MHz<br/>TSOP Gehäuse<br/>Bandbreite: x16<br/>Arbeitsspannung 2,5V</p>     |  <p>256M DDR (+512M)</p>    |

# Consumer Portfolio

## Anwendungen



Digital TV



Digital Still Camera (DSC)



Set-Top Boxes



Printer



DVD Player / Recorder

## Produkteigenschaften

### Langfristige Produktunterstützung:

#### SDR:

- Schnittstellen: x16, x32
- Dichten: 64M – 256M
- Geschwindigkeiten: 133 – 166MHz
- Spannungen: 3,3V



#### DDR:

- Schnittstellen: x8, x16
- Dichten: 128M – 512M
- Geschwindigkeiten: 333 – 400 MHz
- Spannungen: 2,5V



#### DDR2:

- Schnittstellen: x16
- Dichten: 256M – 1G
- Geschwindigkeiten: 533 – 800 MHz
- Spannung: 1,8V



# Mobiles Portfolio

## Anwendungen



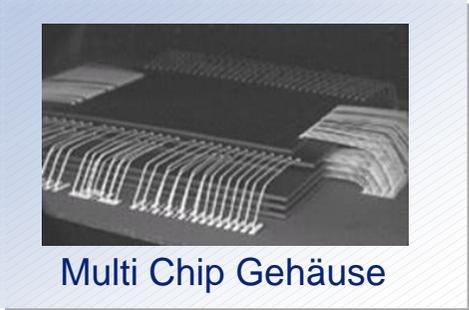
MP3 Player

DSC

Smart Phone



Mobiltelefon

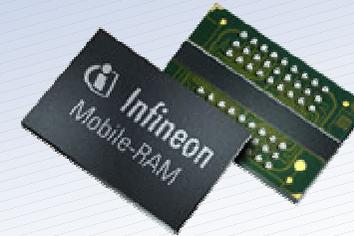


Multi Chip Gehäuse

## Produkteigenschaften

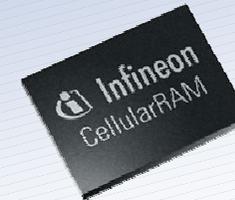
### MOBILERAM

- Geringer Platzverbrauch
- Äußerst niedriger Stromverbrauch

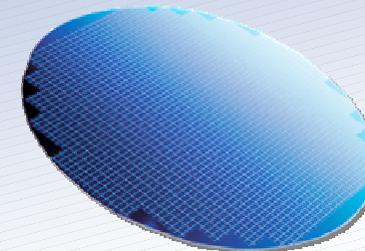


### CellularRAM™

- SRAM Leistung
- Hohe Speicherdichte
- Niedrige DRAM Kostenposition



- Getestete Mobile-RAM und CellularRam Chips
- MCP spezifisches Pad Layout



# Flash Produktportfolio

## Anwendungen



## Produkteigenschaften

### Flash Karten und Drives

- Hochvolumiges Wachstumssegment
- Produkte: SD-Card, MultiMediaCard, mini SD und RS MMC
- USB Flash drive



### Flash Bausteine

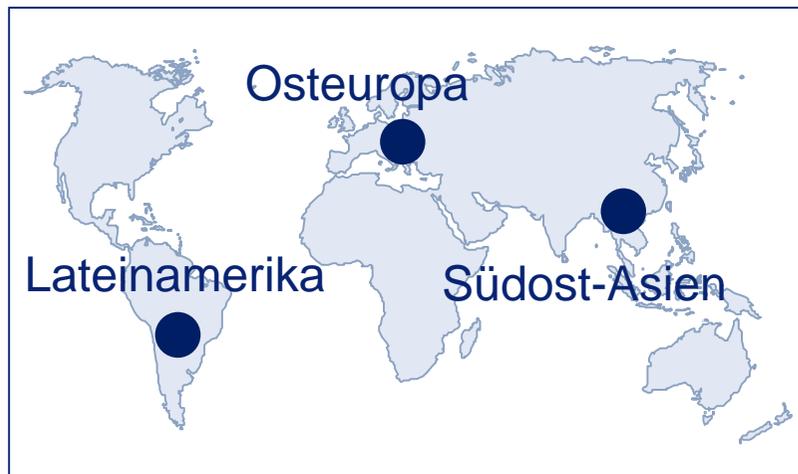
- NAND-kompatible 512 Mbit Flash im TSOP-Gehäuse



# Zweitmarke für DRAM Produkte

## Anwendungen & Markt

- Ausrichtung auf Whitebox PC Markt über Distributionspartner
- Whitebox Markt mit großem Markt-Anteil und Wachstumspotential insbesondere in Schwellenländern Osteuropas, Lateinamerikas and Südost-Asiens



## Produkteigenschaften

- Desktop PC
  - DDR unbuffered DIMMs
  - DDR2 unbuffered DIMMs



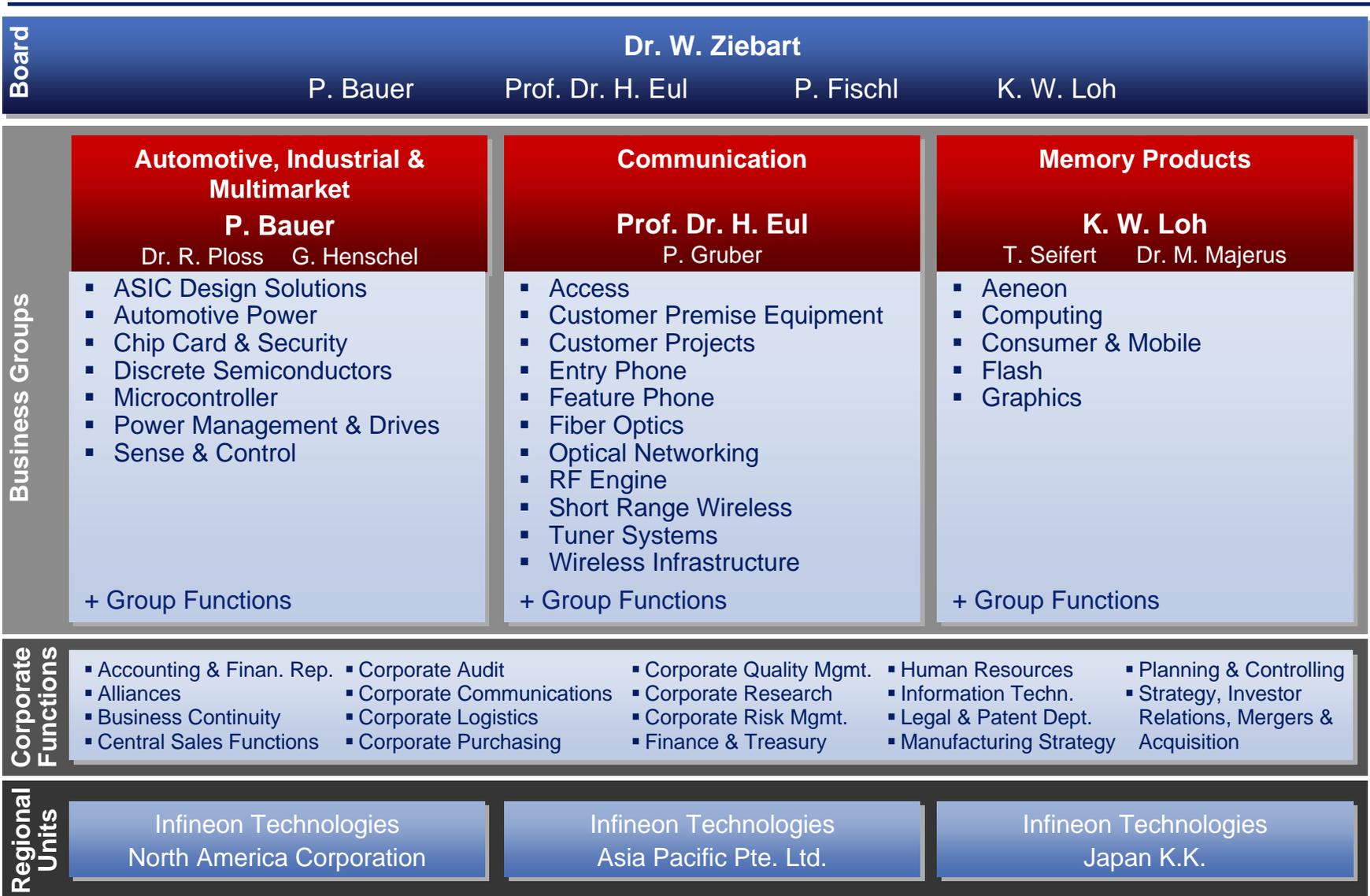
- Notebook PC
  - DDR SO-DIMMs
  - DDR2 SO-DIMMs



---

- Markt    Unternehmensüberblick    Mission
- Geschäftsentwicklung 3. Quartal Geschäftsjahr 2005
- Geschäftsbereiche
- **Allgemeine Unternehmensdaten**

# Infineon Organisation



# Infineon beschäftigt 36.151 Mitarbeiter weltweit\*



\* am 30. Juni 2005

\*\* inkl. ESAS MA

# Kontinuierliche Investitionen in F+E

**F+E - Ausgaben  
GJ 1996-2004 [Mio. EUR]**



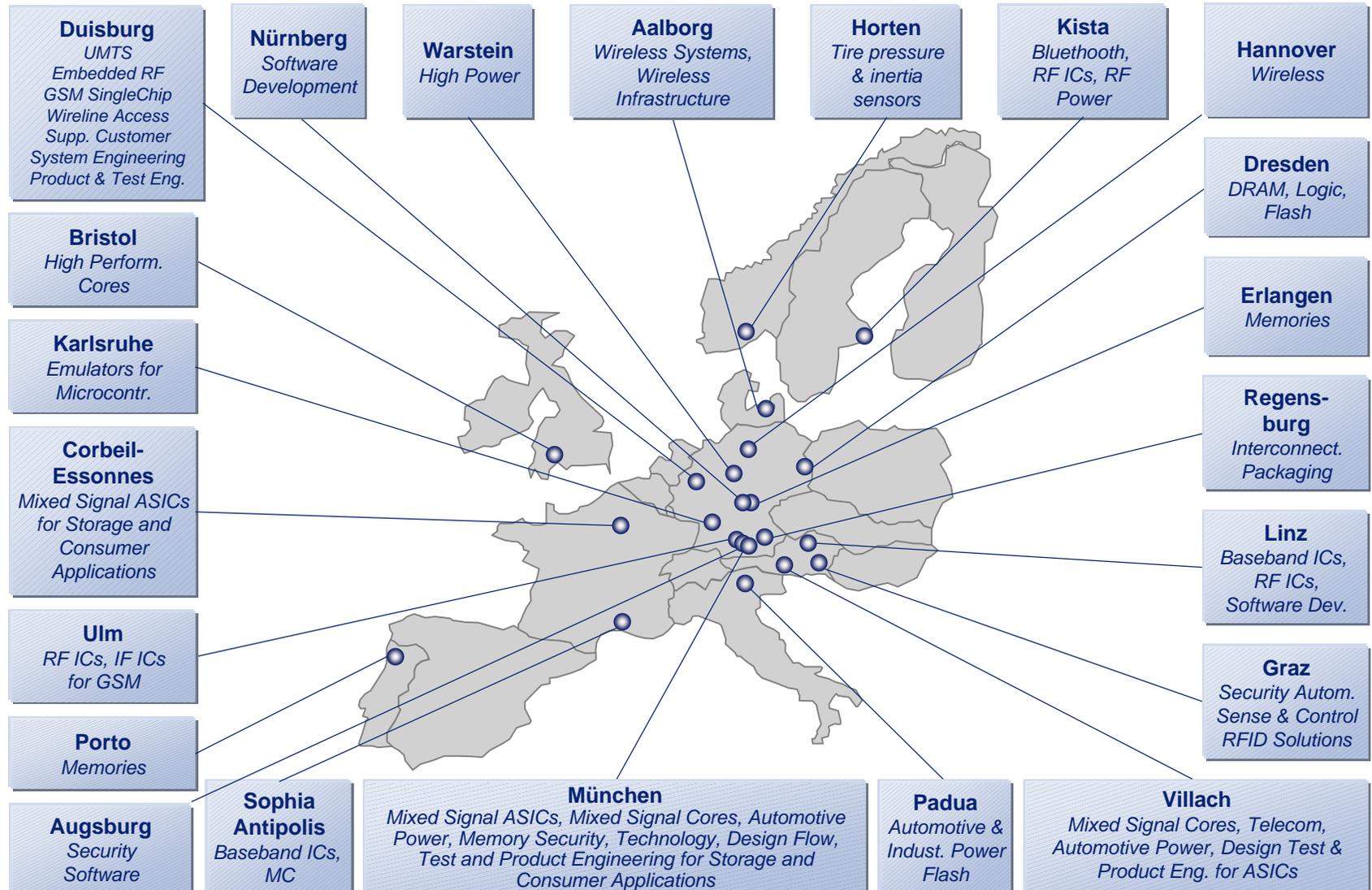
**Anzahl Patente und  
Patentanmeldungen (GJ 1996-2004)**



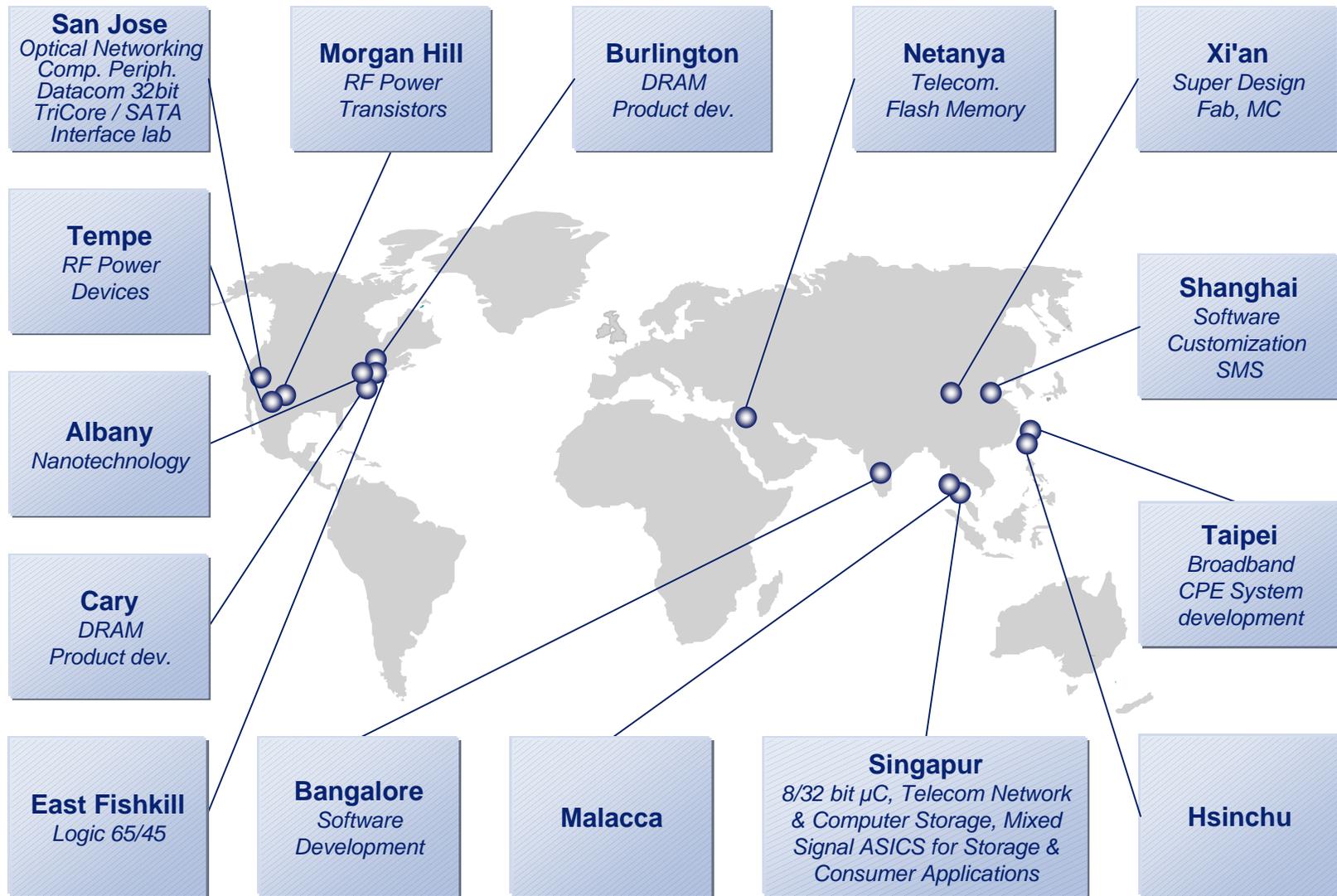
- Ca. 1,2 Milliarden Euro F+E Ausgaben im GJ 2004
- Über 35 Haupt-F+E-Standorte weltweit
- 7.300 Mitarbeiter im Bereich F+E
- Derzeit rund 41.000 Patente / Patentanmeldungen

# Infineon – F+E Netzwerk in Europa

stop thinking  
never

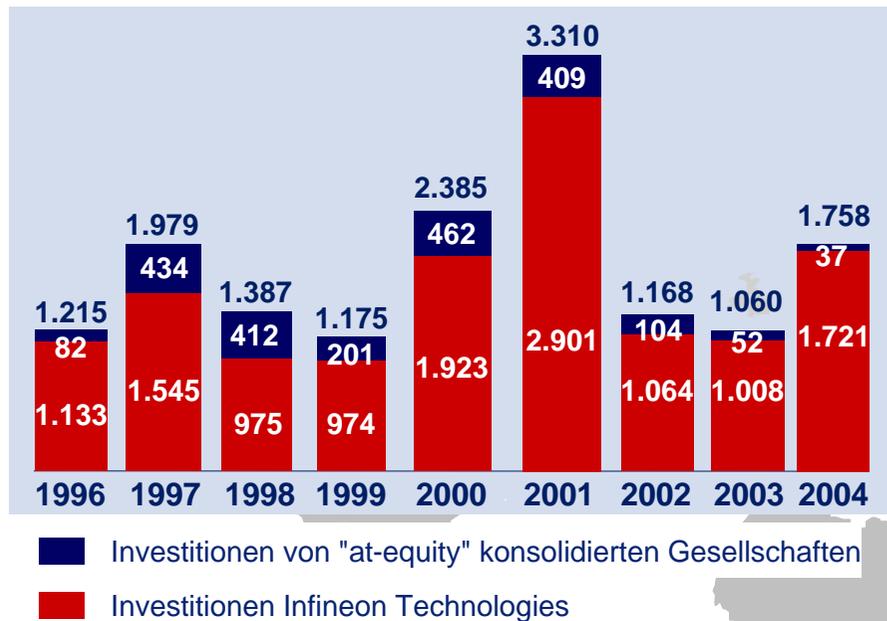


# Infineon – Weltweites F+E Netzwerk (ohne Europa)



# Weltklasse Produktionsstätten auf 3 Kontinenten

**Investitionen  
GJ 1996-2004 [Mio. EUR]**



**8/12-Zoll Produktionsstätten**

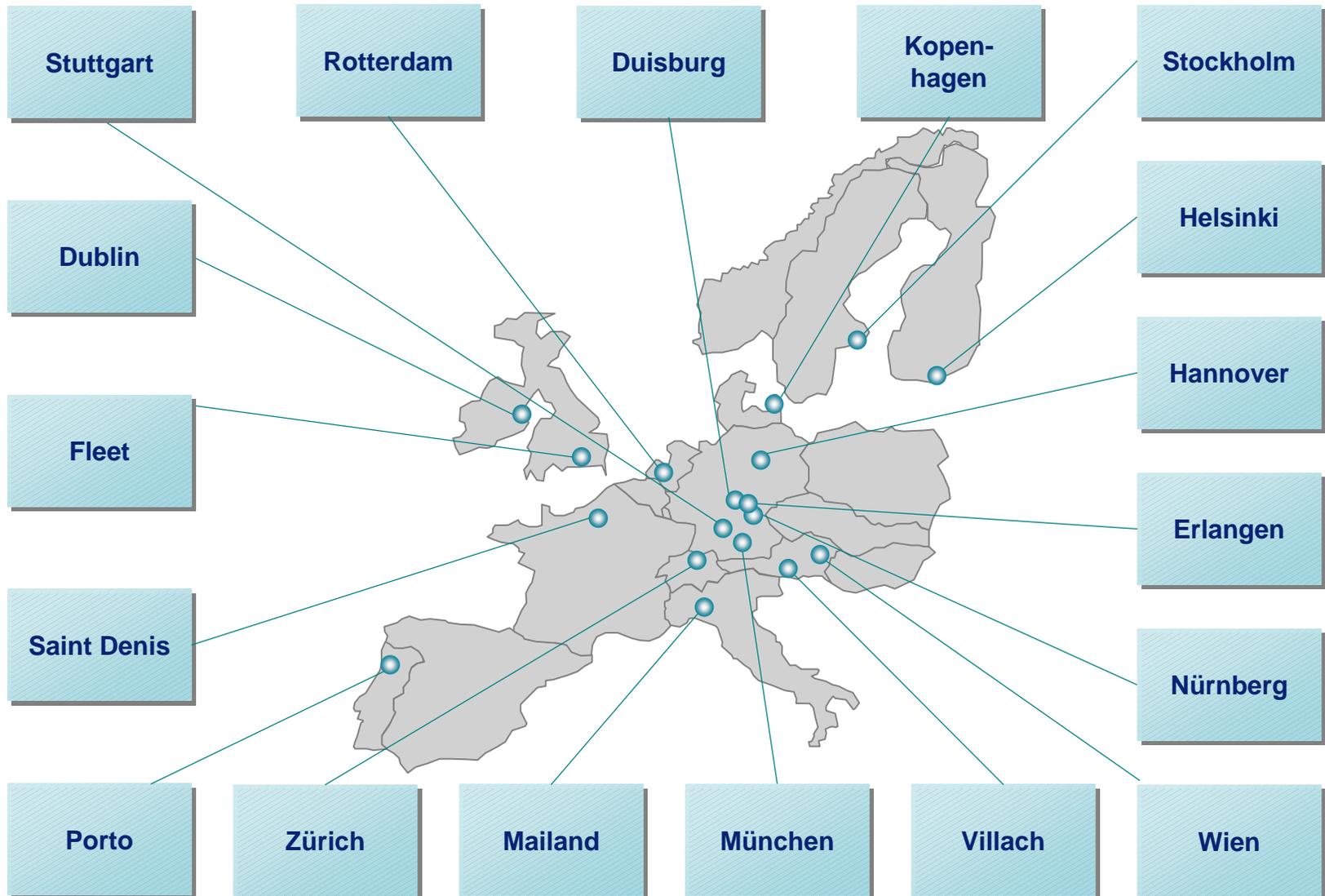
- 1996** Eröffnung (DRAM und Logik), Dresden
- 1998** Eröffnung (DRAM), Richmond (Virginia, USA)
- 1999** ALTIS JV mit IBM gegründet (Logik), Essonnes (Frankreich)
- 2001** Eröffnung 300-mm-Fertigungsmodul Dresden
- 2003** Eröffnung 300-mm-Fertigung Inotera Memories (Taiwan), JV mit Nanya
- 2004** Ausbau von Richmond zu 300-mm-Fertigung

**Mehr als 10 Produktionsstätten (Waferproduktion, Montage und Test)**

# Infineons Produktionsstätten



# Infineon Vertrieb in Europa



# Infineon Vertrieb weltweit (ohne Europa)



# Umfassendes und nachhaltiges Umweltschutz- und Gesundheitsschutzkonzept bei Infineon

## Synergie zwischen ökologischer Verantwortung und wirtschaftlichem Erfolg

- EN ISO 14001 Matrix-Zertifizierung
- Effizientes Ressourcen Management durch optimierten Verbrauch, Aufbereitung, Recycling und Wiederverwendung
  - Intelligentes Abfallmanagement & Emissionsminderung
  - Freiwilliges Bekenntnis zur weltweiten Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen
    - Umweltgesichtspunkte begleiten unsere Produkte, beginnend bei der Entwicklung
    - Umweltauforderungen sind Teil unseres Supply Chain Managements
    - Hohe Standards bei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz



**Für Infineon bedeutet ökologische Verantwortung mehr als nur die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen**



## Green Products

---

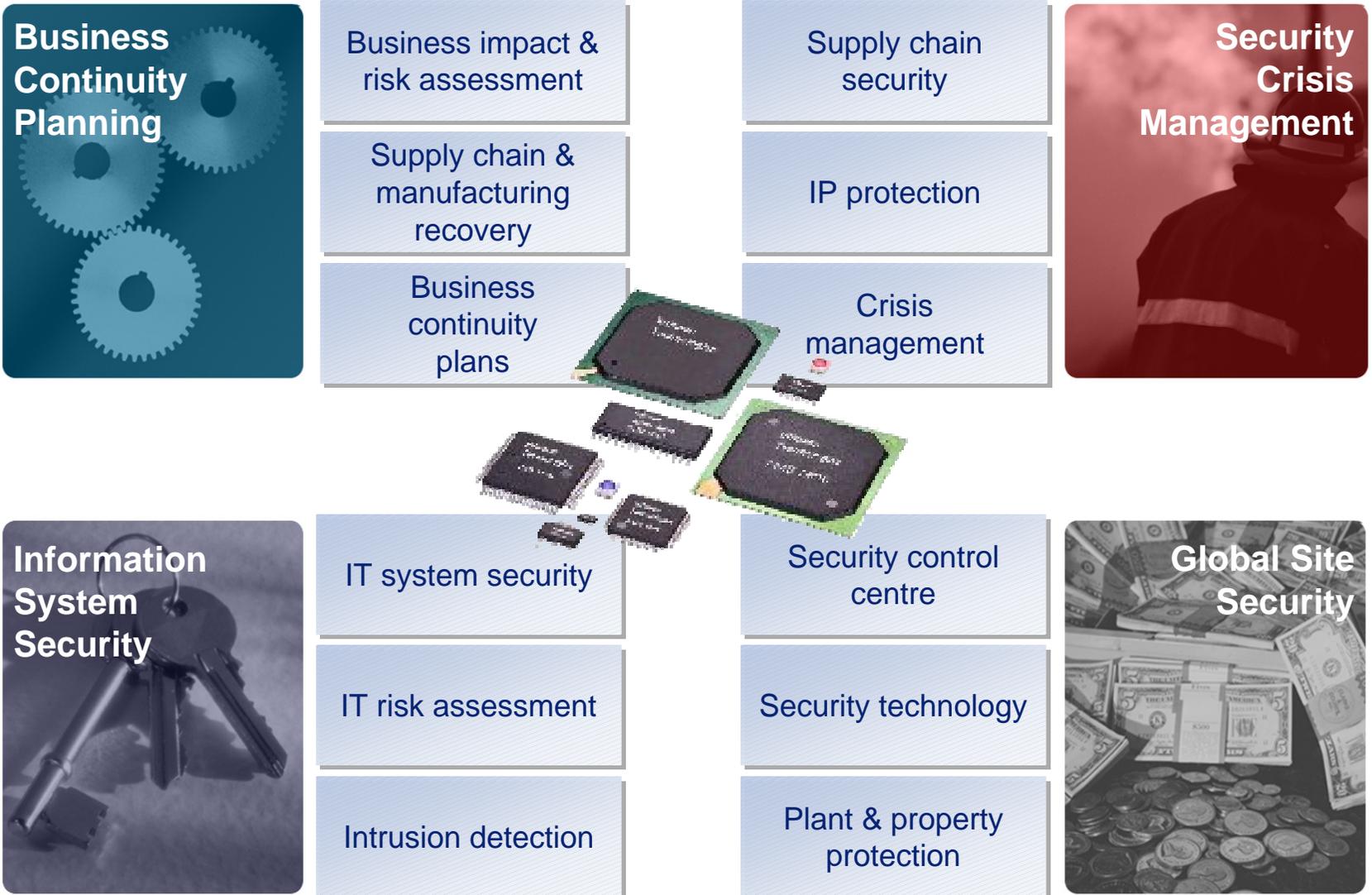
- Seit 1998 wird bei Infineon das Projekt "Green Products" entsprechend den EU Directiven vorangetrieben.
- Mehr als 50 % der Gesamtproduktion ist bereits auf "GREEN" umgestellt worden.
- Die Hauptumstellung erfolgt 2004 / 2005.
- Informationen über Projekt, Technologie und Umstellungspläne finden Sie hier:  
<http://www.infineon.com/greenproduct/index.htm>



*green*  
Product

# Integrierte Geschäftskontinuität, Katastrophenschutz und Sicherheit bei Infineon

stop thinking  
never



# Infineon – weltweit anerkannter Partner der Elektronik-Industrie

stop thinking  
Never

## Automobil-, Industrieelektronik & Multimarket

### Hauptkunden

- |               |           |             |
|---------------|-----------|-------------|
| ■ Autoliv     | ■ Emerson | ■ Micronas  |
| ■ Axalto      | ■ Gemplus | ■ Microsoft |
| ■ Bosch       | ■ G&D     | ■ Motorola  |
| ■ Continental | ■ Hella   | ■ Oberthur  |
| ■ Delphi      | ■ HGST    | ■ Siemens   |
| ■ Delta       | ■ Kostal  | ■ TRW       |
| ■ Denso       | ■ Lear    | ■ Visteon   |

- Main channel partners:  
Arrow, Avnet, Fujitsu Devices, Silicon Applications

## Kommunikation

- |            |              |                 |
|------------|--------------|-----------------|
| ■ Alcatel  | ■ LG         | ■ Samsung       |
| ■ BenQ     | ■ Lucent     | ■ Siemens       |
| ■ CCT      | ■ Matsushita | ■ Sony-Ericsson |
| ■ Ericsson | ■ Motorola   | ■ Sony          |
| ■ Fujitsu  | ■ NEC        | ■ ZTE           |
| ■ Huawei   | ■ Nokia      |                 |

- Electronic Manufacturing Services:  
Celestica, Elcoteq, Flextronics, Hon Hai, Jabil, Sanmina-SCI

## Speicher-Produkte

- |           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| ■ Acer    | ■ Fujitsu  | ■ Kreton   |
| ■ Asustek | ■ Siemens  | ■ Lenovo   |
| ■ ATI     | ■ HP       | ■ Nvidia   |
| ■ Cisco   | ■ HTC      | ■ NEC      |
| ■ Dell    | ■ IBM      | ■ Spansion |
| ■ EMC     | ■ Intel    | ■ Sony     |
|           | ■ Kingston | ■ Sun      |

# Ausweitung des weltweiten Partnerschaft-Netzwerkes\*

## Technology Development

- **AMTC**  
(together with AMD & DuPont)
- **Nanya**
- **IBM**
- **Chartered**
- **Samsung**

## Chip- & Software Development

- **StarCore**  
(together with Agere & Motorola)
- **InterDigital**
- **Emuzed**

## Manufacturing

- **SMIC**
- **Winbond**
- **Inotera**  
(together with Nanya)
- **Altis**  
(together with IBM)

## System Integration & Solutions

- **SAP**
- **Huawei**
- **Broadcom**
- **Richtek**

\* einige der ungefähr 40 Infineon Partnerschaften, Stand September 2004

All company names are registered trademarks.

Copyright © Infineon Technologies 2005. All rights reserved.



**Never stop thinking.**

